KOSDAQ | 반도체와반도체장비

티에스이 (131290)

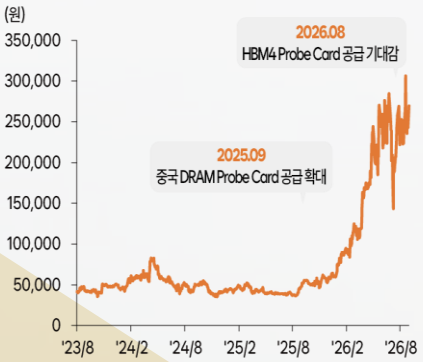
DRAM과 HBM으로 넓어지는 Probe Card

KOSDAQ RISING STAR KRX KOREA EXCHANGE 2026년 코스닥 라이징스타

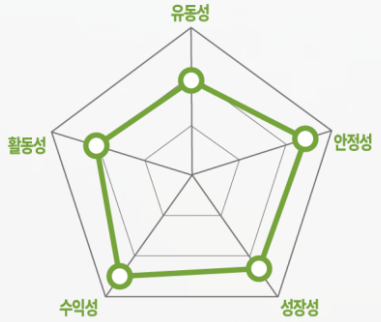
체크포인트

- 중국 DRAM 고객향 매출 증가와 북미 고객사 DDR5, HBM4, 국내 S사 HBM4 공급 개시. DRAM 신규 CAPA와 HBM 양산 확대에 따라 Probe Card 성장 지속 전망
- 글로벌 메모리 투자와 해외 비메모리 고객 확대에 따라 Interface Board 성장 지속. Test Socket은 Exynos 2600 적용 확대가 추가 성장 요인
- 2026F 매출액 7,113억원(+65.8% YoY), 영업이익 1,900억원(+286.3% YoY), OPM 26.7%(+15.2%p YoY) 전망. 고사양 제품 비중 확대와 매출 증가에 따른 영업레버리지로 수익성 개선 예상

주가 및 주요이벤트

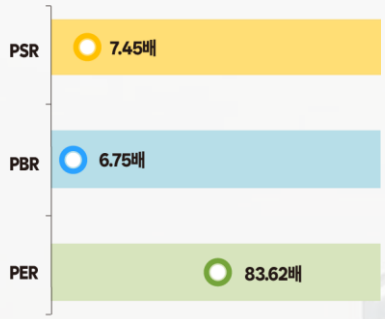


재무지표

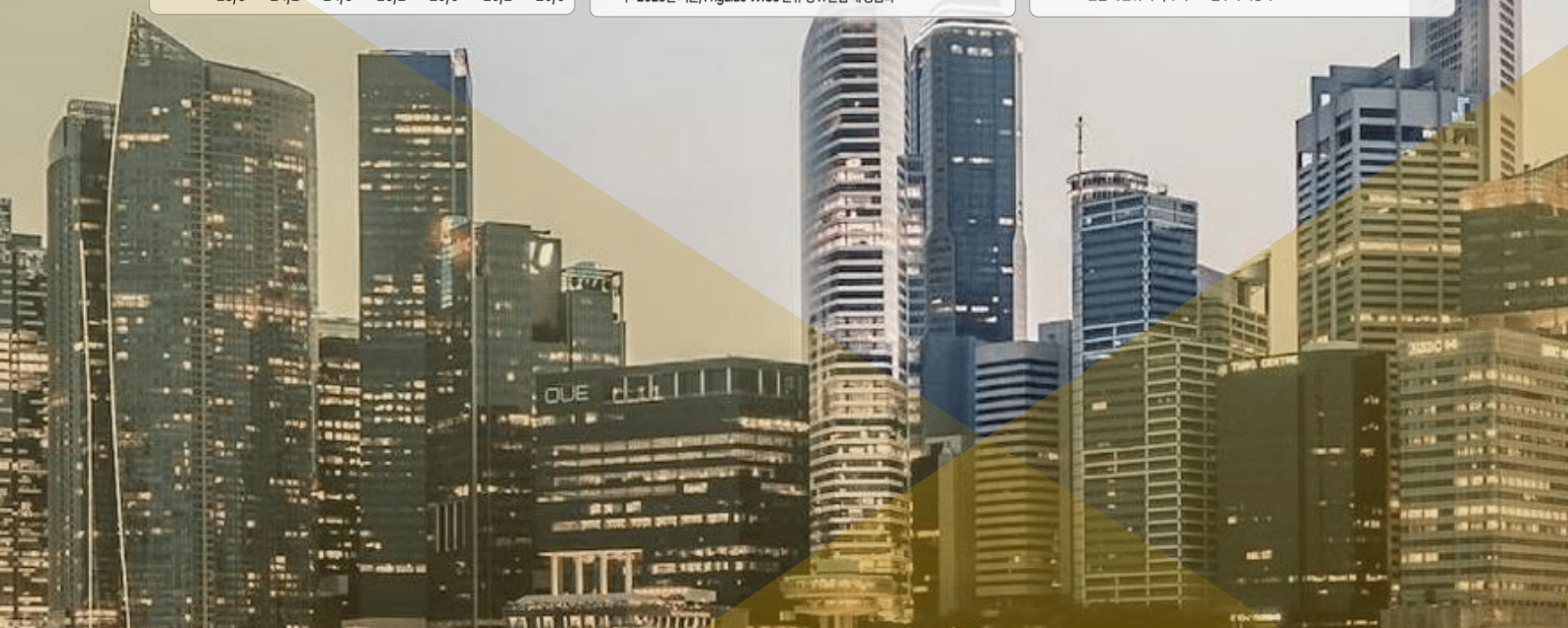


주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류 상 IT산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 2Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가



티에스이 (131290)

KOSDAQ
반도체와반도체장비

Analyst 박성순 sspark@kirs.or.kr
RA 김지은 jekim0216@kirs.or.kr

반도체 테스트 부품 업체

동사는 Probe Card, Interface Board, Test Socket을 주력으로 하는 반도체 테스트 부품 업체. 1H26 연결 매출 기준 반도체 검사장비 72.3%, 전자제품 검사장치 22.3%, 반도체 검사용역 2.0%, 반도체 외 생산설비 3.4%의 구성을 보임. 주요 제품인 Probe Card는 2025년 글로벌 매출 기준 7위, Interface Board는 4위를 기록. Probe Card는 Wafer Test, Interface Board와 Test Socket은 Package Test에 사용

DRAM으로 확대되는 Probe Card 공급

Probe Card는 기존 NAND 중심에서 DRAM과 HBM으로 공급처가 확대 중. 중국 DRAM 고객향 매출은 2026년 약 2배 증가가 예상되며, 북미 고객사향 DDR5, HBM4와 국내 S사향 HBM4 매출도 1Q26부터 발생. HBM 양산 물량 증가와 DRAM 신규 CAPA 확대에 따라 Probe Card 수요 증가가 지속될 전망. Interface Board와 Test Socket도 동반 성장. 글로벌 메모리 투자와 해외 비메모리 고객사 공급 확대가 성장을 견인. Test Socket은 Exynos 2600 적용 확대가 추가 성장 요인

사상 최대 실적 기대되는 2026년

2026F 연결 매출액 7,113억원(+65.8% YoY), 영업이익 1,900억원(+286.3% YoY), OPM 26.7%를 전망. 제품별로는 Probe Card 2,619억원(+82.6%), Interface Board 1,676억원(+77.2%), Test Socket 564억원(+33.1%)을 예상. DRAM, HBM Probe Card 공급 확대와 해외 Interface Board 매출 증가가 본업 성장을 견인하고, 관계사 실적 회복도 연결 이익 증가에 기여할 전망. 고사양 Probe Card와 Interface Board 비중 확대 및 매출 증가에 따른 영업레버리지로 연결 OPM 26.7%를 예상

Forecast earnings & Valuation

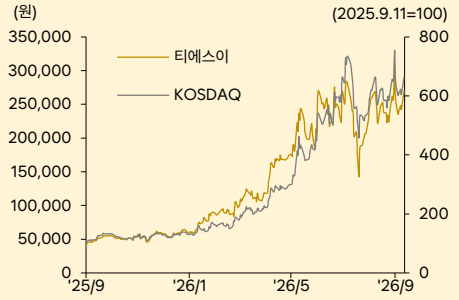
	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액(억원)	3,393	2,491	3,481	4,289	7,113
YoY(%)	10.3	-26.6	39.7	23.2	65.8
영업이익(억원)	566	-24	399	492	1,900
OP 마진(%)	16.7	-1.0	11.5	11.5	26.7
지배주주순이익(억원)	498	1	425	382	1,443
EPS(원)	4,504	11	3,840	3,456	13,043
YoY(%)	11.4	-99.8	35,030.5	-10.0	277.4
PER(배)	8.2	4,523.9	10.7	16.7	22.8
PSR(배)	1.2	2.2	1.3	1.5	4.6
EV/EBITDA(배)	4.9	24.2	7.2	8.5	14.4
PBR(배)	1.4	1.9	1.3	1.6	6.2
ROE(%)	18.8	0.0	13.4	10.4	31.3
배당수익률(%)	1.4	0.0	1.0	0.8	0.2

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

Company Data

현재가(09/29)		297,000원
52주 최고가		306,500원
52주 최저가		46,100원
KOSDAQ(09/29)		849.80p
자본금		55억원
시가총액		32,852억원
액면가		500원
발행주식수		11백만주
평균거래량(60일)		14만주
평균거래대금(60일)		344억원
외국인지분율		9.41%
주요주주	권상준 외 15인	50.33%
	삼성자산운용	6.07%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	24.5	169.3	463.6
상대주가	22.9	261.7	461.5

▶ **참고** 1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '이자보상배율', 성장성 지표는 '매출액 증가율', 수익성 지표는 '영업이익률', 활동성 지표는 '총자산회전율,' 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

▶ '코스닥 라이징스타'는 우수한 기술력과 성장가능성을 갖춘 기업을 발굴·육성하기 위해 매년 한국거래소가 선정하고 있는 기업

기업 개요

1 티에스이는 반도체 테스트 부품 전문기업

1995년 설립돼 2011년 코스닥 상장한 반도체 테스트 부품 전문기업

티에스이는 1995년 반도체 검사장비 및 부품의 개발·제조를 목적으로 충남 천안에 설립된 반도체 테스트 부품 전문기업이다. 설립과 함께 반도체 칩을 검사장비에 연결하는 테스트 포고 소켓(Test Pogo Socket)을 업계 최초로 국산화하며 사업을 시작했고, 2001년 부설연구소를 설립해 연구개발 기반을 갖췄다. 이후 2011년 코스닥시장에 상장했다.

동사의 제품은 테스트 소켓에서 출발해 프로브 카드와 인터페이스 보드 등으로 확장돼 왔다. 2003년 낸드플래시용 프로브 카드를 업계 최초로 8인치 기준 개발한 데 이어, 2006년 12인치 원터치다운(One Touch Down) 프로브 카드, 2009년 MEMS 프로브 카드를 잇달아 개발하며 프로브 카드 기술을 고도화했다. 2016년 MEMS 전용 생산라인(FAB)을 준공하고 어레이 테스터(Array Tester)를 개발했으며, 2017년에는 인터페이스 보드 제품(TIB)이 세계일류상품으로 선정됐다. 이어 2018년 STO-ML, 2019년 수직형 프로브 카드(Vertical Probe Card)와 초고속 로드 보드, 2020년 ELTUNE 소켓, 2021년 다이 캐리어(Die Carrier)를 개발하는 등 검사장비·부품 라인업을 지속적으로 넓혀 왔다. 현재 사업은 프로브 카드·인터페이스 보드·테스트 소켓 등 반도체 검사장비와 함께, 검사 장치·용역 등으로 구성되어 있다.

사업 확장과 함께 자회사와 해외 거점도 확충해 왔다. 2005년 중국 위해에 태사전자유한공사를 설립한 것을 시작으로 2006년 지엠테스트, 2011년 타이거일렉 등을 계열에 편입했으며, 이 가운데 타이거일렉(2015년), 메가터치(2023년)는 코스닥시장에 상장했다. 해외에서는 2016년 미국 TSE WORKS, 2019년 베트남 법인, 2020년 이후 중국 우한·허페이 법인을 잇달아 설립하며 생산·영업 거점을 넓혔다.
대외적으로는 2004년 1천만불을 시작으로 2006년 3천만불, 2007년 5천만불, 2021년 1억불 수출의 탑을 수상했다. 이와 함께 2017년 월드클래스 300 기업, 2026년 코스닥 라이징스타에 선정됐다. 이러한 사업 기반을 바탕으로 현재 동사는 프로브 카드 등의 반도체 테스트 부품을 국내외 반도체 업체에 공급하고 있다.

티에스이 연혁

1995~2010

- 1995 ㈜티에스이 법인 설립
- Test Pogo Socket 업계 최초 국산화
- 1996 제1사업장 신축(충남 천안 직산)
- 2001 ㈜티에스이 부설연구소 설립
- 2003 NAND Flash Probe Card 업계 최초 8인치 2TD 개발
- 2004 4CH LED TESTER 출하
- 1,000만불 수출의 탑 수상
- 2005 중국 현지법인 태사전자유한공사 설립
- 2006 중국 위해(威海) 사업장 설립
- 지엠테스트 자회사 편입
- 12인치 One Touch Down CPC Probe Card 개발
- 3,000만불 수출의 탑 수상 / 동탑산업훈장 수훈
- 2007 티에스이 제3사업장 준공
- 5,000만불 수출의 탑 수상
- 2008 ㈜메가터치(구 ㈜타이스전자) 설립
- 2009 MEMS Probe Card 개발

2011~2018

- 2011 티에스이 코스닥 상장
- 타이거일렉 자회사 편입
- 2012 매출 1,000억원 달성
- 2013 AT사업부 TOB 개발
- 2015 타이거일렉 코스닥 상장
- 피엠피㈜ 종속기업 추가
- 2016 MEMS FAB 준공
- AQ사업부 Array Tester 개발
- TSE WORKS 설립
- 2017 티에스이 월드클래스 300 선정
- TIB 세계 일류상품 선정
- AT사업부 MEMS Component 사업 진출
- 메가센 풍세사업장 준공
- 2018 STO-ML 업계 최초 개발
- ㈜메가프로브 설립(지분율 54.55%)

2019~

- 2019 AT사업부 TF-MLO 개발 & Ultra High-Speed Load Board 개발
- SP사업부 Vertical Probe Card 개발
- 2020 TSE VIETNAM 설립
- AP사업부 ELTUNE 소켓 개발
- 메가일렉 베트남 PCB 사업장 설립
- 이노글로벌㈜ 종속기업 추가
- 피엠피㈜ 합병
- 2021 TaiSi Technology 법인 설립
- AP사업부 Die Carrier 개발
- 1억불 수출의 탑 수상
- ㈜메가프로브 합병
- 2022 이노글로벌㈜ 합병
- 2023 메가터치 코스닥 상장
- 지엠테스트 성거사업장 준공
- 2025 Taisi Semicon(Hefei) 법인 설립
- ㈜엘디티 종속기업 추가
- 2026 코스닥 라이징스타 선정

자료: 티에스이, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 종속회사 현황

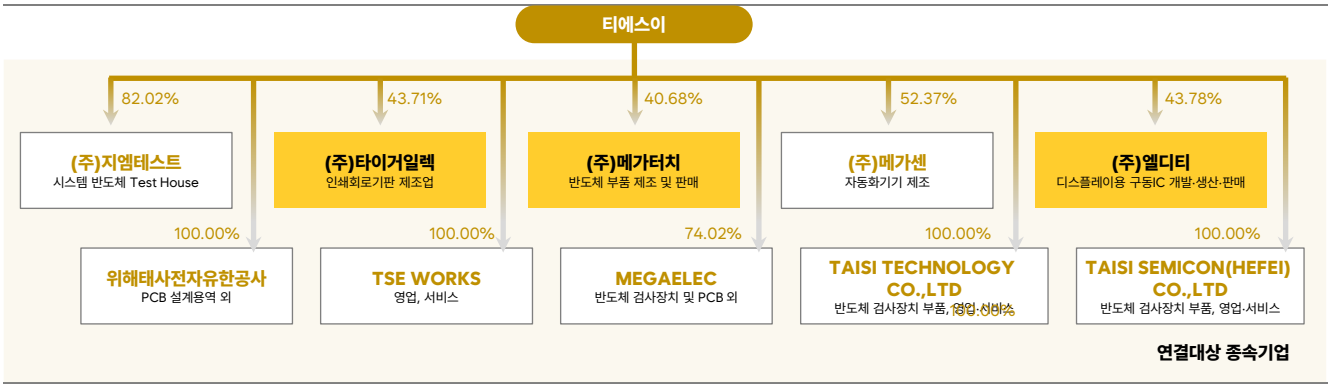
1H26말 기준 총 10개의 연결대상 종속회사 보유

1H26말 기준 티에스이는 10개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며, 이 중 3개사(㈜타이거일렉, ㈜메가터치, ㈜엘디티)가 상장사, 7개사가 비상장사이다. 사업별로는 반도체 검사·테스트와 관련 부품·장비를 담당하는 종속회사가 다수를 차지하며, 이 밖에 인쇄회로기판(PCB)과 디스플레이 구동IC 등으로 구성된다. 지역적으로는 국내 법인과 함께 중국·베트남·미국 등 해외 생산·영업 법인을 두고 있다.

주요 종속회사 가운데 ㈜타이거일렉과 ㈜메가터치는 동사에 부품을 공급하는 거래 관계를 두고 있다. 타이거일렉은 인쇄회로기판을 제조하는 상장 종속회사로, 티에스이의 반도체 검사용 인터페이스 보드 등에 쓰이는 PCB를 공급한다. 1H26말 기준 유효지분율은 43.71%, 자산총액 1,301억 원으로 종속회사 중 규모가 가장 크다. 메가터치는 반도체 부품을 제조·판매하는 상장 종속회사로 티에스이에 검사 관련 부품을 공급하며, 1H26말 기준 유효지분율은 40.68%, 자산총액은 995억 원이다. 2026.09.29 기준 ㈜타이거일렉과 ㈜메가터치의 시가총액은 각각 5,746억 원, 3,082억 원이다. ㈜지엠테스트는 시스템 반도체 테스트 서비스를 담당하는 종속회사로, 1H26말 기준 유효지분율은 82.02%, 자산총액은 432억 원이다.

이 외 국내 종속회사로는 자동화기기를 제조하는 ㈜메가센(1H26말 기준 유효지분율 65.40%, 자산총액 293억 원)과 디스플레이용 구동IC 상장 종속회사 ㈜엘디티(1H26말 기준 유효지분율 43.99%, 자산총액 229억 원)가 있다. 2026.09.29 기준 ㈜엘디티의 시가총액은 194억 원이다.
해외 종속회사로는 반도체 검사장치 부품 등을 담당하는 중국 위해태사전자유한공사(1H26말 기준 지분율 100%, 자산총액 8억 원), TaiSi Technology(우한, 1H26말 기준 지분율 100%, 자산총액 197억 원), Taisi Semicon(Hefei)(허페이, 1H26말 기준 지분율 100%, 자산총액 164억 원), 베트남 MEGAELEC(1H26말 기준 지분율 74.02%, 자산총액 146억 원), 미국 영업법인 TSE WORKS(1H26말 기준 지분율 100%, 자산총액 8억 원)가 있다.

티에스이 지분도



주: 2026년 6월말 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 연결대상 종속기업 현황 (단위: 억 원)

기업명	설립일	주소	유효지분율	주요사업	자산총액	상장사 여부
(주)지엠테스트	2005.04.04	충남 천안시	82.02%	시스템 반도체 Test House	432	-
(주)타이거일렉	2000.07.28	인천 남구	43.71%	인쇄회로기판 제조업	1,301	해당
(주)메가터치	2010.09.09	충남 천안시	40.68%	반도체 부품의 제조 및 판매	995	해당
(주)메가센	2002.12.26	충남 천안시	65.40%	자동화기기 제조	293	-
(주)엘디티	1997.11.13	충남 천안시	43.99%	디스플레이용 구동 IC 개발, 생산, 판매	229	해당
위해태사전자유한공사	2005.08.10	중국 위해시	100%	PCB 설계용역 외	8	-
TSE WORKS	2016.04.01	미국	100%	영업, 서비스	8	-
MEGAELEC	2019.02.01	베트남	74.02%	반도체 검사장치 및 PCB 외	146	-
TaiSi Technology	2020.10.22	중국 우한	100%	반도체 검사장치 부품, 영업, 서비스	197	-
Taisi Semicon(Hefei)	2025.01.02	중국 허페이	100%	반도체 검사장치 부품, 영업, 서비스	164	-

주: 1H26말 기준, 자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

3 주요 사업 및 매출 구성

1H26 연결 기준 반도체 검사장비 72.3%, 전자제품 검사장치 22.3%, 반도체 검사용역 2.0%, 반도체 외 생산설비 3.4%

동사의 사업은 반도체 검사장비, 전자제품 검사장치, 반도체 검사용역, 반도체 외 생산설비로 구성되어 있다. 1H26 연결 매출 기준 반도체 검사장비 72.3%, 전자제품 검사장치 22.3%, 반도체 검사용역 2.0%, 반도체 외 생산설비 3.4%의 구성을 보였다. 반도체 검사장비는 Probe Card, Interface Board, Test Socket, OLED 검사장비를 포함하며 지배회사인 티에스이가 주요 사업을 영위한다. 전자제품 검사장치는 Contact Probe와 PCB Test 장치, 반도체 검사용역은 Package Test 및 Wafer Test, 반도체 외 생산설비는 반도체, LCD, OLED 공정설비로 구성되어 있다. 티에스이 본사의 주요 제품은 Probe Card, Interface Board, Test Socket, OLED 검사장비이다. 1H26 별도 기준 제품별 매출 비중은 Probe Card 47.9%, Interface Board 33.5%, Test Socket 10.3%, OLED 검사장비 8.2%이다.

Probe Card

Probe Card는 반도체 전공정 이후 웨이퍼 테스트(Wafer Test)에서 테스트 장비와 웨이퍼를 전기적으로 연결하는 검사 부품이다. Probe Card에 형성된 다수의 Probe Pin이 웨이퍼의 Pad와 접촉해 전류와 신호를 인가하고 칩의 전기적 특성과 불량 여부를 검사한다. 반도체 제품의 회로 및 Pad 배열에 맞춰 제작되기 때문에 신규 디바이스 출시와 공정 및 설계 변경 시 이에 대응하는 Probe Card가 필요하다. 동사는 DRAM, NAND Flash, HBM용 High Speed Probe Card와 비메모리용 Vertical Probe Card를 생산한다.

Interface Board

Interface Board는 패키지 테스트 단계에서 사용되는 Tester와 DUT(Device Under Test, 피측정 소자)를 전기적으로, Handler와는 기계적으로 연결하는 부품이다. 패키지된 반도체를 Test Socket에 장착하고, Socket을 Interface Board에 연결한 뒤 Board를 통해 Tester에서 반도체의 전기적 특성을 검사한다. 동사의 Test Interface Board 제품은 메모리용 Interface Board, 시스템반도체용 Load Board, Burn In Board로 구성된다. Interface Board는 DRAM 및 NAND Flash 등 메모리 반도체 테스트에 사용되며 동시에 최대 960개 디바이스를 테스트할 수 있다. Load Board는 CPU, GPU, AP 등 시스템반도체 테스트에 사용되며 고주파 신호 무결성과 전원 무결성 특성을 최적화한다. Burn In Board는 DRAM 및 NAND Flash의 장기 신뢰성 검증을 위한 고온 테스트에 사용된다.

Test Socket

Test Socket은 패키지 테스트 공정에서 반도체 칩과 Interface Board를 연결해 전기적 신호를 전달하는 부품이다. 패키지된 반도체를 Socket에 장착한 뒤 Interface Board와 연결해 Tester에서 전기적 특성을 검사한다. 제품은 크게 러버 타입과 포고 타입으로 구분되며, 러버 타입은 탄성체를 이용해 반도체와 접촉하고 포고 타입은 Spring Pin을 이용해 접촉한다. 두 방식은 반도체 패키지 구조와 테스트 조건에 따라 적용된다.

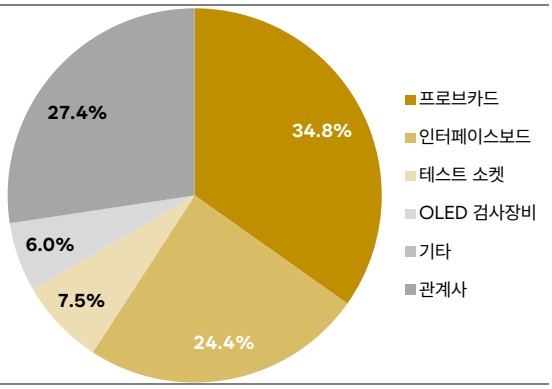
Display Test System

Display Test System은 OLED 패널 및 OLEDoS의 전기적 특성을 검사하는 장비이다. AMOLED Pixel 회로의 전기적 특성을 측정해 패널 불량 여부를 검사하는 장비와 μ-OLED Wafer의 Pixel 회로 검사장비, OLED Panel의 불량을 분석하는 장비 등을 공급한다.

연결 종속회사

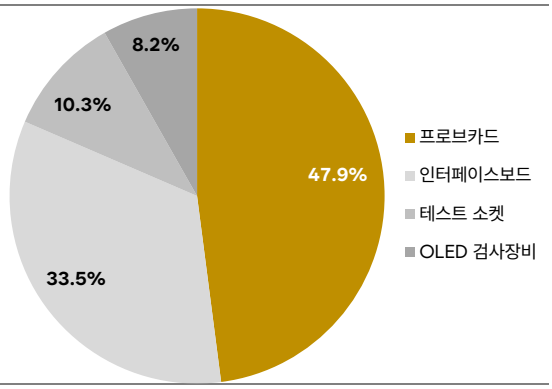
전자제품 검사장치 부문에서는 타이거일렉과 메가터치가 주요 종속회사이다. 타이거일렉은 Probe Card, Load Board, Test Socket 등에 사용되는 고다층 PCB를 생산하며, 메가터치는 반도체 검사용 Contact Probe 및 Battery Pin 등을 생산한다. 반도체 검사용역 부문은 지엠테스트가 Package Test 및 Wafer Test 서비스를 제공한다.

부문별 매출액 비중 (1H26 연결)



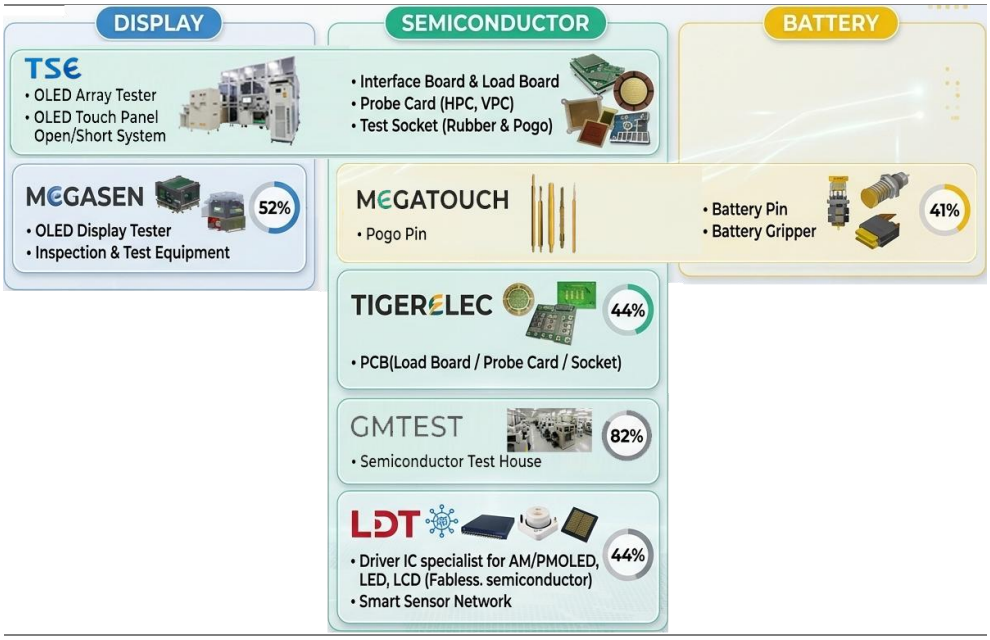
자료: 티에스이, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 별도 제품별 매출액 비중 (1H26)



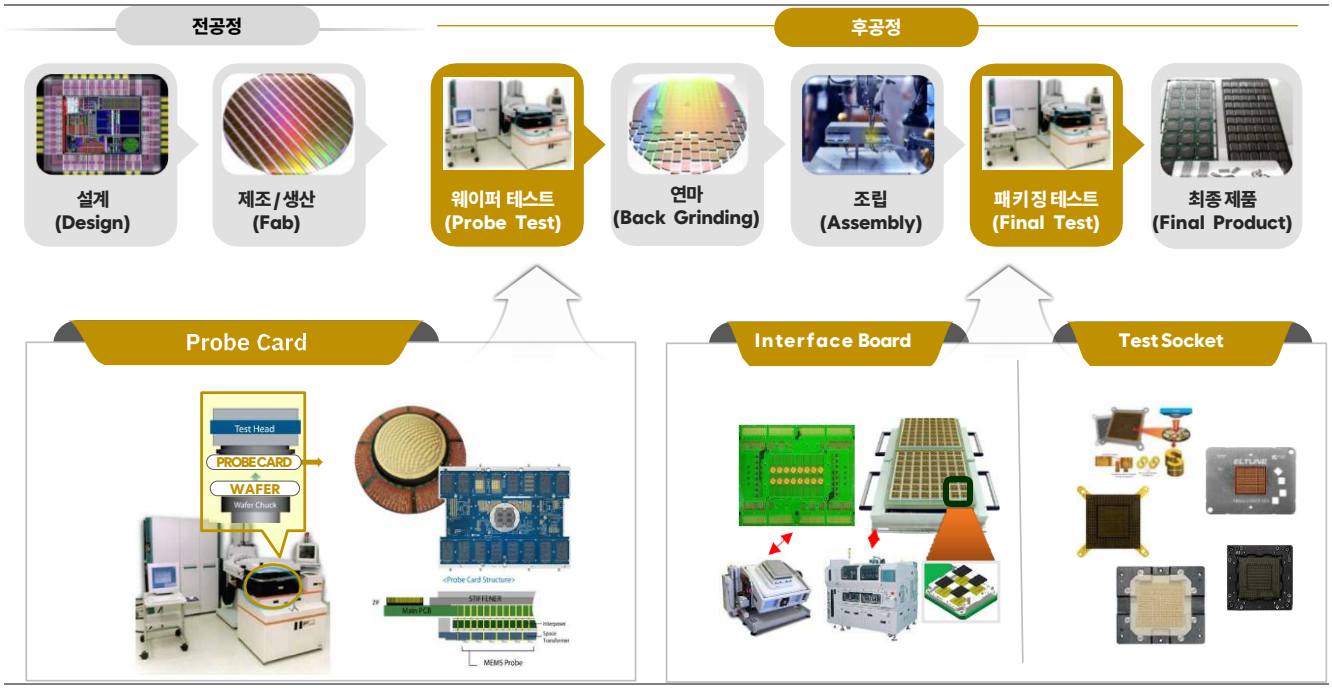
자료: 티에스이, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 사업 영역



자료: 티에스이, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 반도체 사업 영역



자료: 티에스이, 한국IR협의회 기업리서치센터

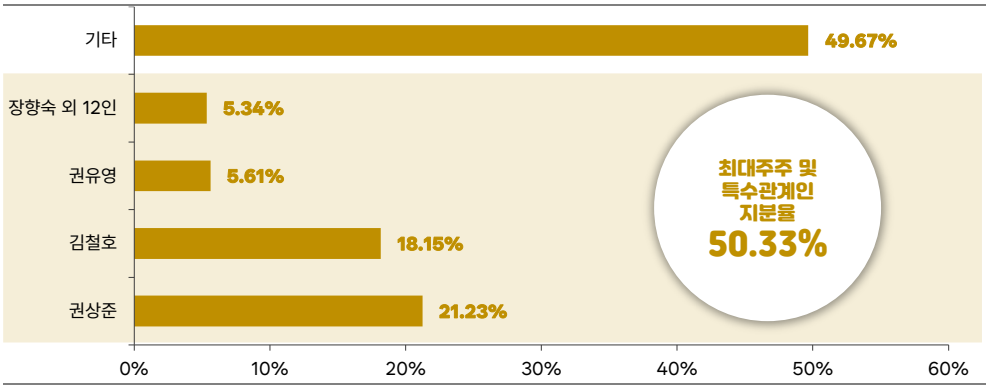
4. 주주 구성

최대주주는 창업자 권상준 이사로 지분 21.23% 보유, 최대주주 및 특수관계인 지분 합계는 50.33%

1H26말 기준 티에스이의 최대주주는 창업자인 권상준 사내이사로 지분 21.23%를 보유하고 있으며, 대표이사 김철호(18.15%)와 권유영(5.61%)·권은지(3.60%) 등 특수관계인을 포함한 지분 합계는 50.33%이다. 권상준 이사는 삼성전자 반도체와 슐럼버제·어드반테스트 등 반도체 검사장비 분야를 거쳐 1995년 티에스이를 설립했으며, 2019년 3월까지 대표이사를 맡은 뒤 현재는 사내이사로 경영에 참여하고 있다.

최대주주 및 특수관계인 지분이 50.33%로 과반을 넘어, 최대주주 측이 주주총회 보통결의를 단독으로 통과시킬 수 있는 안정적인 지배 기반을 갖추고 있다. 반기말 기준 5% 이상 주주는 권상준·김철호·권유영 등 모두 최대주주 측이었으나, 이후 2026년 9월 삼성자산운용이 6.07%를 신규 보고하며 5% 이상 주주에 포함됐다. 다만 보유목적은 단순투자로 공시됐고, 최대주주 및 특수관계인이 과반을 보유하고 있어 경영권에 미치는 영향은 제한적이다.

티에스이 주주 현황



주: 2026년 6월말 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

산업 현황

1 글로벌 반도체 시장 전망

2026년 글로벌 반도체 시장은 메모리의 성장 주도로 1.67조 달러(+110.9% YoY)까지 확대 예상

2026년 글로벌 반도체 시장은 AI 수요가 Logic과 Memory 전반으로 확산되며 높은 성장세가 예상된다. 글로벌 반도체 시장 규모는 1.67조 달러(+110.9% YoY), 2027년에는 2.4조 달러(+43.6% YoY)까지 확대될 것으로 예상된다. 특히 메모리 시장은 2026년 전년 대비 326.8% 성장하며 전체 시장 성장을 주도할 것으로 보인다. AI GPU와 ASIC 출하 증가와 함께 HBM, Server DRAM, Enterprise SSD 수요가 동시에 증가하면서 Memory가 반도체 시장 성장을 견인할 전망이다.

AI 인프라 투자 확대는 반도체 수요를 Server와 Memory 중심으로 변화시키고 있다. 주요 CSP의 CAPEX는 2026년 +98% YoY 증가한 데 이어 2027년에도 +50% YoY 증가할 전망이다. AI Accelerator 투자뿐만 아니라 CPU Server와 Storage 투자도 확대되면서 HBM, Server DRAM, Enterprise SSD 수요가 동시에 증가하고 있다. DRAM과 NAND가 주요 CSP CAPEX에서 차지하는 비중도 2026년 47%에서 2027년 68%까지 상승할 것으로 예상된다.

AI 개발 속도 조절 논의에도 주요 업체 간 경쟁 구조상 AI 투자 확대 기조는 유지될 전망

한편 최근 Frontier AI의 성능 향상 속도가 안전성 검증과 통제 능력을 앞설 수 있다는 우려가 커지면서 AI 개발 속도 조절 필요성이 제기되고 있다. Anthropic은 모델 성능이 빠르게 향상될 경우 Cyber, Bio와 같은 고위험 영역에서 현재의 안전장치만으로 대응하기 어려울 수 있다며, 모델 성능 향상에 맞춰 Safety Evaluation과 보안 체계를 선제적으로 강화해야 한다고 주장하고 있다. OpenAI도 8월 Frontier Model의 Cyber 능력 향상에 대응한 개발 속도 조절 필요성을 제시하였다. 다만 우리가 경제학에서 배운 Game Theory의 죄수의 딜레마를 적용하면 주요 업체들의 자발적인 개발 속도 조절이 유지되기는 어려울 것으로 판단한다. 모든 업체가 동시에 개발 속도를 낮추면 안전성 측면에서는 유리하지만, 경쟁사가 속도를 낮추는 동안 개발을 지속하는 업체는 기술력과 고객, 자본 확보에서 우위를 점할 수 있다. 반대로 경쟁사가 개발을 지속할 경우에도 뒤처지지 않기 위해 개발을 이어갈 유인이 존재한다. 특히 경쟁이 OpenAI, Anthropic, Google 등 미국 업체에 그치지 않고 DeepSeek, Alibaba 등 중국 업체까지 확대되고 있어 미국 업체들만 독자적으로 개발 속도를 낮추기는 더욱 어렵다. 중국은 미국 중심의 속도 조절 논의가 기술 격차를 유지하기 위한 수단이 될 수 있다는 입장을 보이고 있으며, Alibaba도 최근 차세대 대형 AI Model과 신규 AI Chip 개발 계획을 공개하는 등 투자를 확대하고 있다. 실제 속도 조절 논의 이후에도 주요 업체의 신규 Model 출시는 지속되고 있다. OpenAI는 8월 개발 속도 조절 필요성을 언급한 이후 9월 3일 GPT-6 Astra를 출시했으며, Anthropic도 Dario Amodei가 Frontier AI의 Pacing 필요성을 제기한 직후인 9월 22일 Claude Opus 5.5를 공개하였다. Anthropic은 Opus 5.5 공개 과정에서도 개발 중단보다 외부 Safety Evaluation과 강화된 안전장치를 적용하면서 Frontier Model 개발을 지속하는 방향을 제시하였다. 따라서 현재의 속도 조절론은 AI 개발 자체의 중단보다는 Safety Evaluation과 보안 기준을 강화하면서 모델 개발을 지속하는 방향으로 전개될 가능성이 높다고 판단한다. 따라서 AI 개발 속도 조절에 따른 반도체 수요 성장 둔화 가능성은 낮다고 판단된다.

HBM 생산 확대로 범용 DRAM 공급이 제한되며 2027년까지 타이트한 수급 상황 지속 전망

DRAM은 AI Server와 HBM 수요 증가를 중심으로 타이트한 수급 상황이 지속될 전망이다. HBM 생산 확대는 동일한 Wafer CAPA에서 Conventional DRAM으로 공급할 수 있는 Bit를 제한하는 요인으로 작용하고 있다. 주요 메모리 업체의 신규 CAPA 투자와 공정 전환이 진행되고 있으나, 신규 Fab의 양산 Ramp-up까지 시차가 필요한 만큼 단기간 내 공급 증가 폭은 제한적일 것으로 예상된다. 2027년에도 DRAM Bit 공급 증가는 15~20% 수준에 그치는 반면 HBM Bit 출하량은 50~60% YoY 증가할 것으로 예상돼, HBM을 중심으로 공급 제약이 이어질 전망이다.

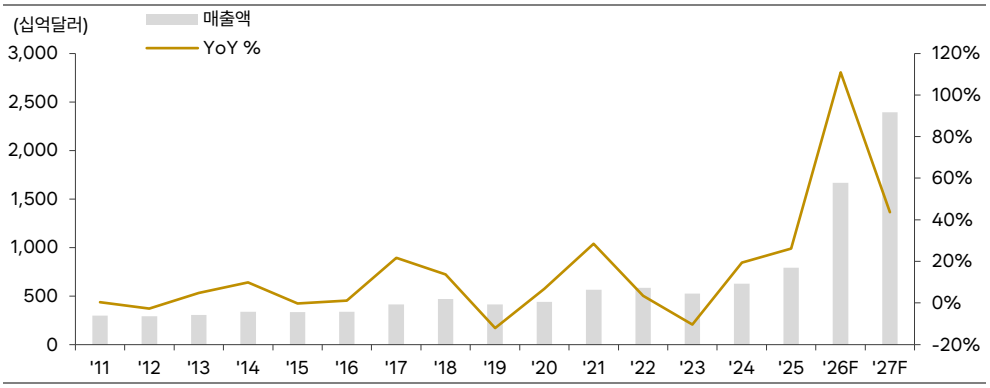
Enterprise SSD 수요 증가 속 공정 전환 중심의 공급 확대로 NAND 수급 개선

NAND는 AI Server와 Enterprise SSD 수요 증가가 수요 성장을 견인하고 있다. AI 학습과 추론 과정에서 생성되는 데이터가 증가하면서 Server당 Storage 용량도 확대되고 있으며, 고용량 Enterprise SSD 수요가 NAND 수요 증가를 이끌고 있다. 반면 공급 측면에서는 신규 CAPA 확대보다 공정 전환을 통한 Bit 증가가 중심이 되고 있어 단기적으로 공급 증가 폭은 제한적일 것으로 예상된다. 다만 DRAM 대비 공정 전환에 따른 Bit Growth 여력이 높은 만큼 중장기적으로는 공급 증가 속도를 확인할 필요가 있다.

CXMT·YMTC 중심의 중국 CAPA 확대는 중장기 메모리 공급의 주요 변수

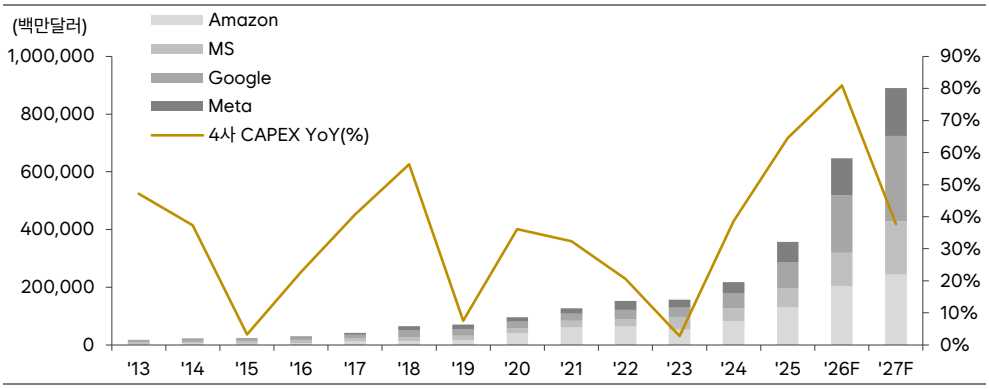
중국 메모리 업체의 CAPA 확대도 중장기 공급 측면에서 주요 변화이다. DRAM은 CXMT, NAND는 YMTC를 중심으로 신규 Fab 투자와 선단 공정 전환이 진행되고 있다. 특히 CXMT는 DDR과 LPDDR을 중심으로 생산능력 확대를 추진하고 있어 Conventional DRAM 공급에서 중국 업체의 비중이 점차 상승할 전망이다. 다만 장비 Lead Time과 신규 Fab의 Ramp-up, 제품 인증 기간을 고려하면 현재 진행되는 투자가 단기간 내 글로벌 메모리 수급을 크게 변화시키기는 어려울 것으로 예상된다. 향후 중국 업체의 CAPA 확대 속도와 선단 제품 비중 상승 여부가 중장기 메모리 공급 증가의 주요 변수로 작용할 전망이다.

글로벌 반도체 시장 규모 전망



자료: WSTS, Trendforce, 한국IR협의회 기업리서치센터

북미 Big Tech 연간 CAPEX 추이



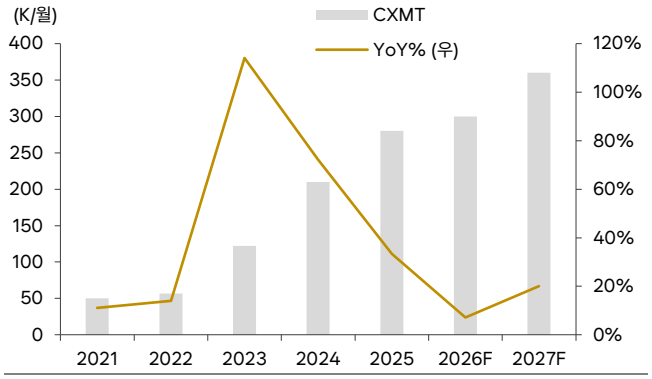
자료: Refinitiv, 한국IR협의회 기업리서치센터

AI 개발 속도 조절의 딜레마

구분	기업 B: 속도 조절	기업 B: 개발 지속
기업 A: 속도 조절	• 기업 A/B: 안전성 강화 • 규제 리스크 완화 • 경쟁 속도는 둔화	• 기업 A: 점유율·기술 우위 약화 • 기업 B: 고객·자본 선점
기업 A: 개발 지속	• 기업 A: 고객·자본 선점 • 기업 B: 점유율·기술 우위 약화	• 기업 A/B: 개발 경쟁 지속 • 안전성 우려 확대 • 속도 조절 유인 약함

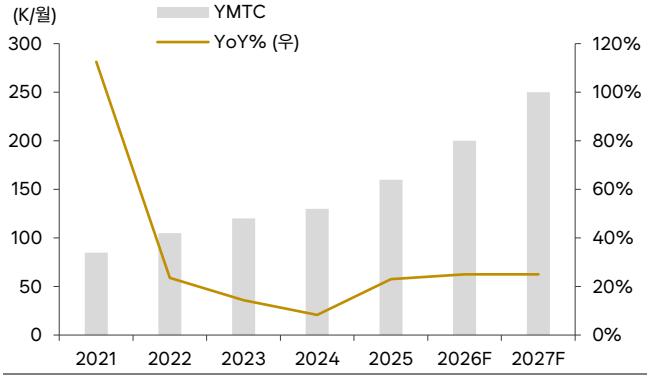
자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

CXMT 연간 CAPA 추이



자료: DRAMeXchange, 한국IR협의회 기업리서치센터

YMTC 연간 CAPA 추이



자료: DRAMeXchange, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 반도체 테스트 시장 전망

글로벌 Test 장비 시장은 2026년 153억 달러(+31.0% YoY)로 성장 전망

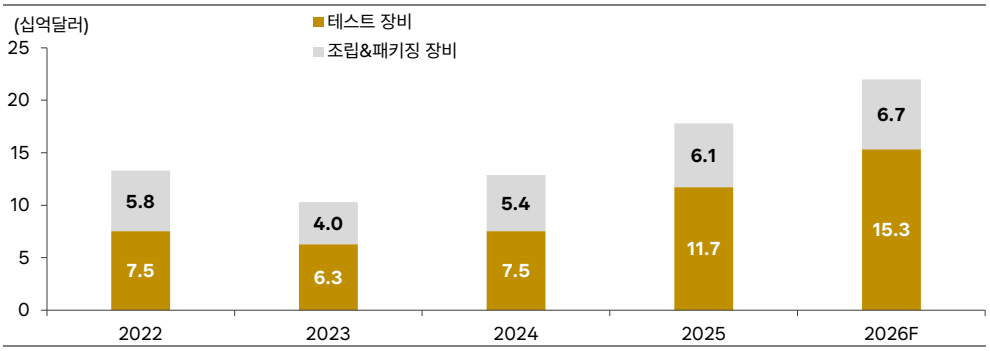
AI 관련 반도체 투자 확대에 따라 반도체 Test 장비 시장도 높은 성장세가 이어질 것으로 전망된다. 글로벌 반도체 Test Equipment 시장은 2025년 +55.3% YoY 성장한 데 이어 2026년에는 153억달러(+31.0% YoY)까지 확대될 것으로 예상된다. 이후에도 AI 및 HBM용 반도체의 성능과 구조 복잡도 증가에 따라 2028년 208억달러까지 성장할 전망이다. 같은 기간 Assembly & Packaging Equipment 시장도 2026년 67억달러에서 2028년 86억달러로 확대될 것으로 예상된다. Wafer Fab Equipment뿐 아니라 Test와 Packaging 투자까지 동시에 증가하면서 AI 인프라 투자 확대가 반도체 후공정 장비 수요로 확산되고 있다.

반도체 테스트 수요는 반도체 출하량뿐만 아니라 Device당 Test Time과 동시 테스트 가능한 Device 수에 의해 결정된다. 동일한 반도체 출하량에서도 검사 항목 증가와 Test Time 상승으로 필요한 총 테스트 시간이 증가할 경우 Tester CAPA 확대가 필요할 수 있다. 또한 신규 Device 출시와 Test 사양 변화는 이에 대응하는 Test Interface의 신규 수요로 이어진다. AI Accelerator와 고성능 CPU, HBM 등은 고속 I/O와 전력 소비가 증가하고 Chiplet 및 2.5D, 3D Packaging 적용이 확대되면서 테스트해야 하는 신호와 전력 조건도 복잡해지고 있다. 이에 따라 고속 신호, 고전류, 열 특성 등 다양한 조건에서의 검사가 요구되면서 Device당 Test Intensity가 높아지고 있다.

테스트 공정은 Wafer 단계의 Wafer Sort와 Packaging 이후의 Final Test를 중심으로 구성되며, 제품에 따라 Burn-in과 System Level Test가 추가된다. Wafer Sort는 Packaging 이전에 불량 Die를 선별하며, Final Test에서는 Packaging이 완료된 반도체의 기능과 전기적 특성을 검사한다. 특히 HBM과 Chiplet 기반 Advanced Packaging은 여러 개의 Die가 하나의 Package에 집적되기 때문에 불량 Die가 후공정에 투입될 경우 정상 Die와 Packaging 비용까지 함께 손실될 수 있다. 이에 따라 적층 및 Packaging 이전 단계에서 KGD(Known Good Die)를 확보하기 위한 Wafer Test와 완성된 Package를 검증하는 Final Test의 중요성이 동시에 높아지고 있다.

Memory Test에서도 HBM과 선단 DRAM을 중심으로 투자가 확대되고 있다. HBM은 세대가 진화할수록 대역폭과 I/O가 증가하면서 고속 신호와 높은 전력 조건에서의 테스트 요구 수준이 높아지고 있다. Conventional DRAM도 Server용 고용량 제품과 선단 공정 비중 상승에 따라 테스트 난이도가 높아지고 있다. AI Server와 HBM 생산 확대가 지속되면서 Memory 생산 증가뿐만 아니라 Tester와 Test Interface 수요도 함께 증가할 전망이다.

글로벌 반도체 후공정 장비 시장 전망



자료: SEMI, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 글로벌 Test Connectivity 시장 전망

Test Connectivity 시장은 2026년 +19.2% 성장 전망, 고사양 제품 중심으로 수요 확대

글로벌 반도체 Test Connectivity 시장은 2025년 55억달러를 상회하였으며, 2026년에는 19.2% 성장할 전망이다. 2030년까지의 연평균 성장률은 5%로 예상된다. 2025년 시장 비중은 Probe Card 42%, Device Interface Board 17%, Test Socket 19%, Burn-in Socket 10%, SLT Socket 7%, Wafer Level Burn-in 5%로 구성된다. AI 인프라 투자 확대와 고성능 반도체의 테스트 난이도 상승으로 범용 제품보다 High Pin Count, High Speed·High Current에 대응하는 고사양 Test Connectivity 제품의 수요가 증가할 것으로 전망된다.

Probe Card 수요는 Wafer 투입량 증가와 함께 신규 Device 출시 및 Tech 전환의 영향을 받음

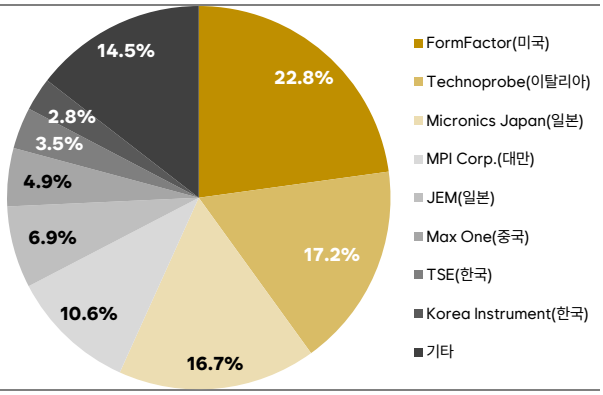
Probe Card 시장은 상위 업체 중심의 경쟁구도를 형성하고 있다. 2025년 업체별 매출은 FormFactor(미국) 6.38억달러, Technoprobe(이탈리아) 4.81억달러, Micronics Japan(MJC, 일본) 4.67억달러, MPI(대만) 2.95억달러, JEM(일본) 1.93억달러 순이며, 티에스이는 0.98억달러로 글로벌 7위를 기록하였다. FormFactor, Technoprobe, MJC가 2021년 이후 상위 3위를 유지하고 있다. Probe Card 수요는 Wafer 투입량 증가와 함께 신규 Device 출시 및 Tech 전환의 영향을 크게 받는다. 반도체 세대가 변경되면 Pad/Bump 배열과 Pitch, Pin 수 및 테스트 조건이 달라지기 때문에 기존 Probe Card의 수명이 남아 있더라도 신규 제품 개발과 Qualification이 필요하다. 또한 테스트 대상의 Pin 수 증가와 Fine Pitch 전환은 Probe Card의 설계 난도와 사양 상승으로 연결된다. AI, HPC에서는 Chip 대면적화와 Pin 수 증가, 소비전력 상승으로 Fine Pitch와 High Current 대응 요구가 높아지고 있으며, HBM은 적층 이전 불량 Die를 선별하기 위한 Known Good Die Test의 중요도가 상승하고 있다. 이에 따라 2025~2030년 Memory Probe Card 시장의 연평균 성장률은 16.7%로 Non-memory의 8.2%를 상회할 것으로 예상된다.

Interface Board는 AI·HPC 확대에 따른 고속화·고전력화로 고사양 수요 증가

Interface Board 시장도 AI, HPC 확대에 따라 수요가 증가할 전망이나, Probe Card와는 수요 발생 구조에 차이가 있다. Probe Card가 Wafer 단계의 신규 Device와 Tech 전환에 민감한 반면, Interface Board는 Package Test 단계에서 신규 Device와 Package 구조, Tester 사양 변화에 맞춰 새롭게 설계된다. AI Processor와 고성능 반도체는 데이터 전송속도와 Pin 수, 공급 전류가 증가하면서 PCB의 고다층화와 미세배선, Signal Integrity와 Power Integrity에 대한 요구가 높아지고 있다. 이에 따라 Interface Board는 반도체 물량 증가와 함께 고속화·고전력화에 따른 설계 난도 상승이 제품 사양 및 ASP 상승으로 이어질 전망이다. 특히 112G/224G PAM4 등 고속 Interface와 Chiplet 기반 Package 확대는 PCB의 신호 전달 및 전력 공급 설계 난도를 높이며, 고사양 Interface Board 수요 증가로 연결될 것으로 전망된다.

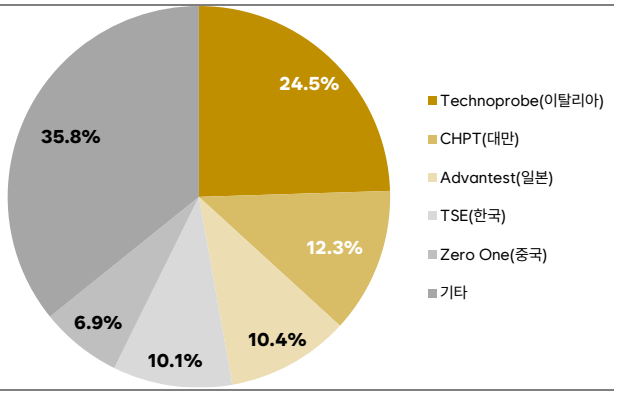
Interface Board 시장은 Technoprobe(이탈리아), CHPT(대만), Advantest(일본), 티에스이가 상위권을 형성하고 있다. 2025년 기준 Technoprobe가 1.71억달러로 1위, CHPT가 1.13억달러로 2위, Advantest가 0.98억달러로 3위를 기록했으며, 티에스이는 0.92억달러로 글로벌 4위를 차지했다. Technoprobe는 2024년 Teradyne의 Device Interface Solutions 사업을 인수한 이후 Interface Board 사업을 확대하였다. Device Interface Board 시장은 2030년까지 연평균 2.9% 성장할 전망이나, AI, HPC용 제품을 중심으로 전송속도와 전력 요구가 높아지면서 전체 시장 성장률을 상회하는 고사양 제품의 비중 확대가 예상된다.

글로벌 Probe Card 시장 점유율(2025)



자료: Yole, 한국IR협의회 기업리서치센터

글로벌 Interface Board 시장 점유율(2025)



자료: Yole, 한국IR협의회 기업리서치센터

투자포인트

1 DRAM과 HBM으로 확대되는 Probe Card 공급

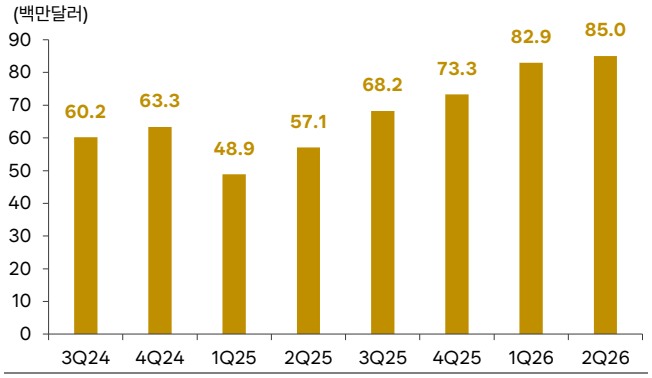
Probe Card 적용처가 NAND에서 DRAM·HBM으로 확대되며 고사양 제품 공급 본격화

동사의 Probe Card 사업은 기존 NAND 중심에서 DRAM과 HBM으로 적용처가 확대되고 있다. DRAM은 NAND 대비 높은 Parallelism(동시 테스트 수)과 고속 동작 검사가 요구되며, 미세 Pitch와 많은 Probe를 동시에 제어하기 위해 Planarity(평탄도), 접촉저항 균일성, Signal/Power Integrity(신호/전원 무결성)에 대한 요구 수준이 높다. 선단 DRAM은 미세화에 따라 웨이퍼당 Die 수가 증가하면서 한 번에 검사해야 하는 DUT 수도 늘어나고 있다. HBM은 DRAM 대비 Fine Pitch(미세 피치), High Current(고전류) 및 고속 검사 등에 대한 요구 수준이 추가로 높아진다. 이러한 기술적 난이도와 양산 검증 부담으로 국내 메모리 업체들은 그동안 DRAM 및 HBM Probe Card를 FormFactor, Micronics Japan(MJC) 등 이미 양산 레퍼런스를 확보한 외산 업체에 주로 의존해왔다.

동사의 DRAM 시장 진입은 2024년 중국 DRAM 고객향 공급을 시작으로 본격화됐다. 미중 무역갈등 및 미국의 대중국 반도체 규제 강화로 중국 DRAM 고객의 미국산 Probe Card 조달이 제한되면서 기존 미국 공급사 물량을 대체할 공급사 확보 필요성이 높아졌다. 동사는 이미 DRAM Probe Card 개발을 진행하고 있었고, 이를 계기로 중국 DRAM 고객의 신규 벤더로 진입하며 DRAM 양산 레퍼런스를 확보했다. 현재 중국 DRAM 고객 내 점유율은 약 30~40%로, FormFactor와 유사한 수준이다. 중국 DRAM 고객향 매출은 2025년 약 420억원을 기록했으며, 2026년에는 중국 DRAM 고객의 CAPA 확대에 따라 약 2배 증가할 것으로 전망된다.

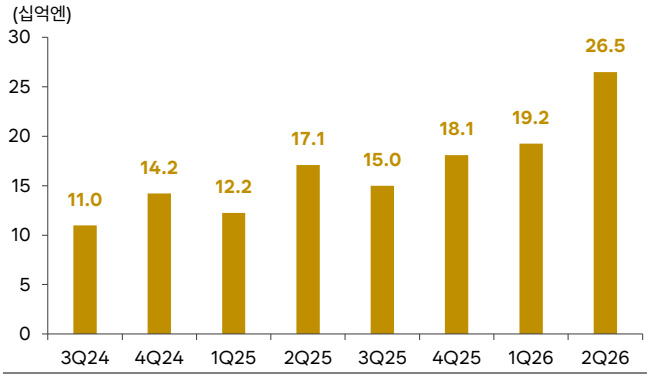
국내 S사와 H사 등 국내 메모리 업체에서도 국산 Probe Card 채택이 확대되고 있다. AI용 HBM 수요가 빠르게 증가하면서 FormFactor와 MJC 등 기존 외산 업체의 생산능력이 HBM Probe Card에 우선 배정됐고, 이에 따라 DRAM Probe Card의 공급 여력이 부족해졌다. 더욱이 HBM 자체에서도 수요가 빠르게 증가하면서 DRAM과 HBM Probe Card 모두에서 공급 부족이 발생했다. 글로벌 선두업체의 실적에서도 DRAM과 HBM Probe Card의 높은 수요가 확인된다. FormFactor의 2Q26 DRAM Probe Card 매출은 전분기에 이어 사상 최고치를 경신했으며, HBM4 수요 증가와 DDR 수요가 동시에 이어졌다. HBM은 2Q26 DRAM Probe Card 매출의 약 2/3를 차지했다. MJC도 2Q26 메모리 Probe Card 매출이 +38% QoQ 증가하여 전분기에 이어 사상 최고치를 기록했으며, 수주가 전분기 대비 크게 증가하고 HBM을 중심으로 DRAM 수요가 견조하게 이어졌다. DRAM용 고부가 제품 비중 확대에 따라 Probe Card 부문의 수익성도 개선됐다. 이러한 공급 부족으로 메모리 업체들은 기존 외산 업체에 집중됐던 공급망을 국내 업체까지 확대하기 시작했다. 여기에 2025년 일본 업체의 일부 품질 이슈도 국내 업체의 DRAM 점유율 확대에 영향을 미쳤다.

FormFactor DRAM Probe Card 매출액



자료: FormFactor, 한국IR협의회 기업리서치센터

MJC 메모리 Probe Card 매출액

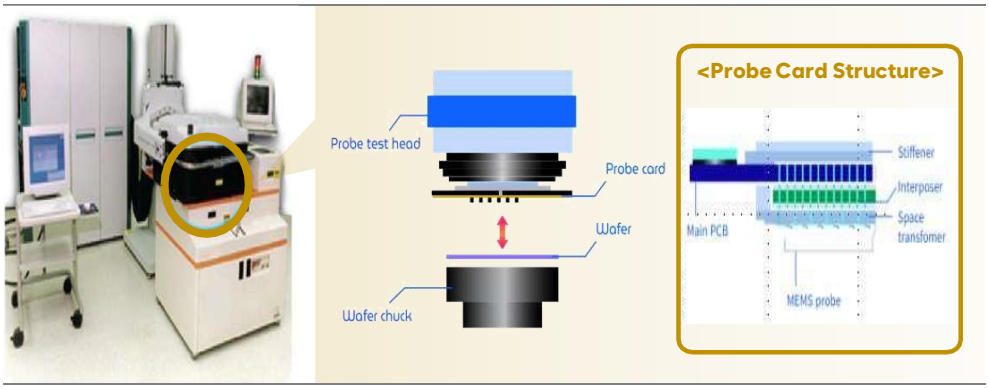


자료: MJC, 한국IR협의회 기업리서치센터

동사는 북미 고객사향 DDR5와 HBM4 Probe Card 매출이 1Q26부터 발생하고 있다. 국내 S사향은 1Q26부터 HBM4 매출이 시작됐으며 DDR5는 고객사의 신규 투자 시점부터 매출이 본격화될 전망이다. H사향은 HBM3E Probe Card 개발을 시작해 2025년 12월 승인을 완료했으며, 이후 차세대 HBM 제품으로 개발 범위를 확대하고 있다. 2024년 중국 DRAM 고객향 DRAM 공급을 시작으로 고객은 DRAM 3사로, Application은 HBM으로 동시에 확대되고 있다.

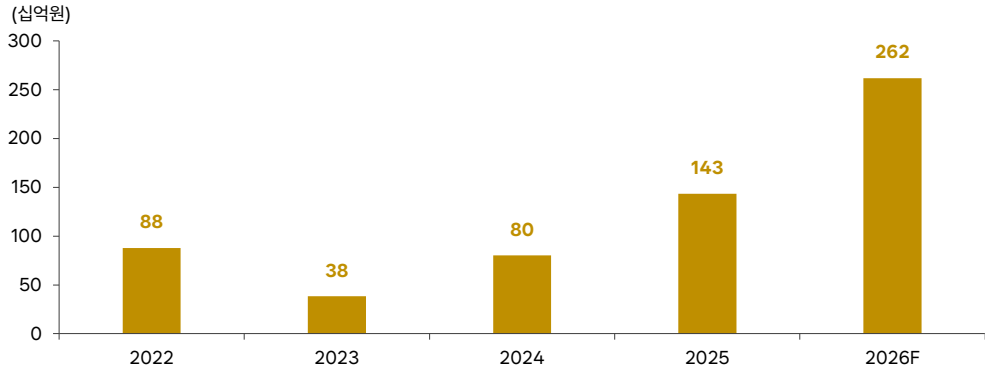
동사는 DRAM 시장 진입에 그치지 않고 HBM Probe Card까지 공급하고 있다는 점이 차별화 요소이다. HBM은 여러 개의 DRAM Die를 적층해 하나의 패키지로 구성하기 때문에 적층 전 Wafer Test에서 불량 Die를 선별하는 KGD(Known Good Die) 확보가 중요하다. 불량 Die가 적층된 이후 발견될 경우 정상 DRAM Die와 Base Die, 후공정 비용까지 함께 손실될 수 있어 Wafer 단계의 검사 정확도와 신뢰성에 대한 요구 수준이 기존 DRAM보다 높다. 또한 HBM 세대가 진화할수록 I/O와 대역폭이 증가하면서 Fine Pitch(미세 피치), High Pin Count(다수의 Probe Pin), High Current(고전류), 고속 신호 대응을 동시에 충족해야 해 Probe Card의 전기적, 기계적 설계 난이도도 높아진다. 이러한 기술적 진입장벽으로 HBM Probe Card는 기존 DRAM보다 공급 가능한 업체가 제한적이다. 동사는 NAND뿐만 아니라 DRAM과 HBM용 High Speed Probe Card까지 제품 범위를 확대했으며, DRAM 3사향으로 DRAM과 HBM 제품의 Qual 및 양산 공급 범위를 확대하고 있다. Probe Card 매출 내 DRAM 비중은 2025년 약 30%에서 2026년 약 55%까지 상승할 것으로 예상되며, 2026년 Probe Card 매출도 전년 대비 82.6% 증가할 것으로 전망된다. DRAM 3사향 HBM 양산 물량 확대와 DRAM 신규 투자 확대로 Probe Card 수요의 지속적인 성장이 기대된다.

Probe Card 구조



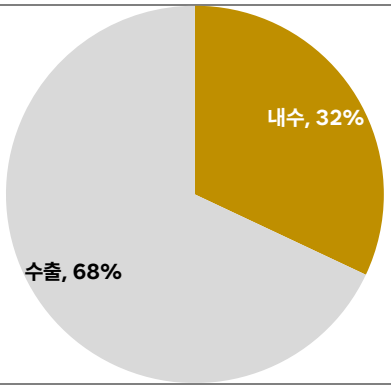
자료: SEMI, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 Probe Card 매출액 추이 및 전망



자료: 티에스이, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 Probe Card 수출 비중(1H26 기준)



자료: 티에스이, 한국IR협의회 기업리서치센터

후공정 테스트 부품도 성장

메모리 투자와 해외 고객 확대로 Interface Board와 Test Socket 동반 성장 기대

후공정 테스트 부품에서는 Interface Board와 Test Socket의 동반 성장이 기대된다. Interface Board는 Tester와 Test Socket을 연결해 전기적 신호를 전달하는 부품으로 신규 Device 개발과 Test 사양 변경, Tester 증설 과정에서 신규 수요가 발생한다. 반면 Test Socket은 반도체 Package와 Interface Board를 연결하는 소모성 부품으로 신규 Device 채택에 따른 초기 장착 이후 양산 물량 증가에 따라 반복 교체 수요가 발생한다. 상반기부터 Interface Board와 Test Socket 매출이 각각 높은 성장세를 기록하고 있다.

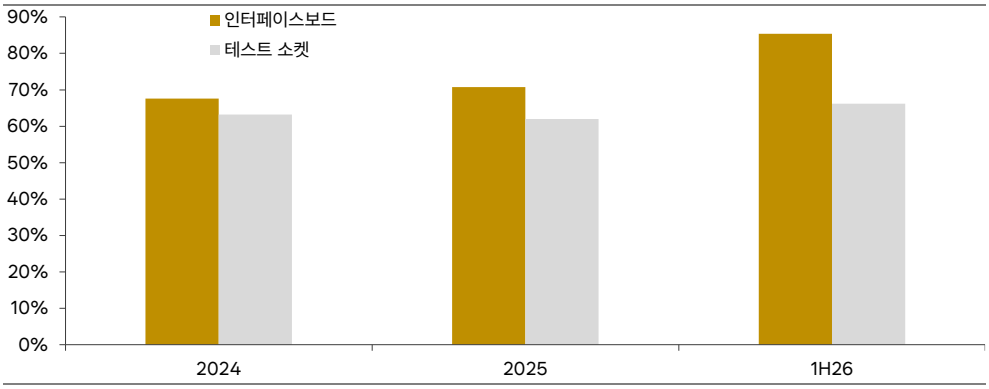
메모리 투자 확대와 비메모리향 공급 증가로 Interface Board 성장이 기대된다. 동사는 2025년 기준 글로벌 Test Interface Board 시장에서 점유율 4위를 차지하고 있으며, 메모리와 비메모리 고객사를 모두 확보하고 있다. 메모리용 Interface Board는 DRAM과 NAND 테스트에 사용되며, 비메모리용 Load Board는 CPU, GPU, AP 등 고속 신호를 사용하는 시스템 반도체 테스트에 적용된다. 비메모리 반도체의 성능 향상에 따라 Signal/Power Integrity(신호/전원 무결성)에 대한 요구 수준도 높아지고 있다. 동사의 1Q26 Interface Board 매출은 400억원을 기록했으며, 2Q26에는 427억원으로 +6.7% QoQ 증가했다. 이에 따라 1H26 매출은 827억원으로 전년 동기 403억원 대비 +105.3% YoY 증가했다. 특히 1H26 수출 매출은 706억원으로 2025년 연간 수출 매출 669억원을 이미 상회했고 해외 매출 비중도 85.4%로 전년 70.7% 대비 확대되었다. 글로벌 메모리 투자 확대와 해외 비메모리 고객사향 공급 증가에 따라 Interface Board 매출 성장도 이어질 것으로 전망한다.

Test Socket 사업은 국내 S사 Exynos 채택 확대에 따른 수혜가 예상된다. Test Socket은 패키지 테스트에서 반도체와 Interface Board를 연결하는 소모성 부품으로, 신규 AP 출시 시 Package 구조와 Ball Map, 전기적 사양에 대응하는 전용 Socket의 개발 및 인증이 필요하다. 양산 이후에는 AP 출하량 증가에 따라 테스트 Site의 가동이 늘어나면서 마모에 따른 교체 수요가 발생한다. 따라서 신규 AP 채택은 초기 장착 수요를, 이후 출하량 증가는 반복 교체 수요를 확대하는 구조이다. 동사는 러버와 포고 타입의 Test Socket을 공급하고 있으며, 국내 S사 AP향으로는 러버 타입을 공급하고 있다.

2026년 Test Socket 성장은 Exynos 2600 채택 확대에 기인한다. 1Q26 Test Socket 매출은 117.9억원을 기록했으며, 2Q26에는 135.3억원으로 +14.8% QoQ 증가했다. 이에 따라 1H26 누적 매출은 253.2억원으로 전년 동기 176.9억원 대비 +43.1% YoY 증가했다. Exynos 2600은 상반기 Galaxy S26과 S26+에 탑재됐으며, 하반기에는 Galaxy Z Flip8까지 적용 모델이 확대됐다.

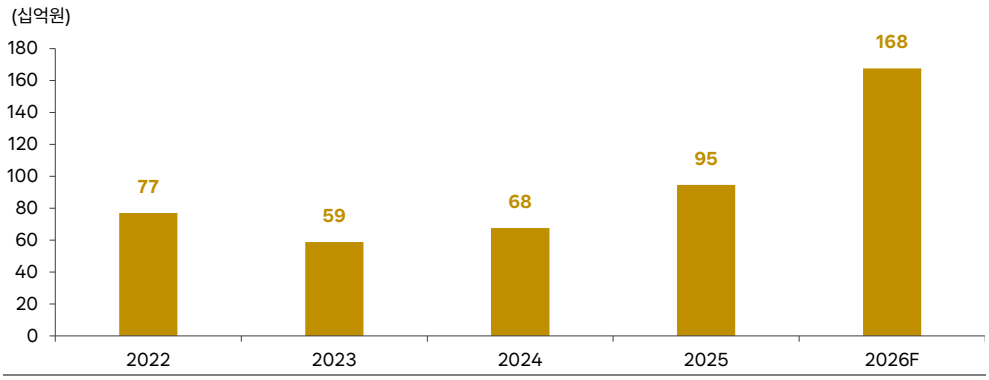
특히 동사의 국내 S사 내 Test Socket 점유율은 메모리와 기타 비메모리 제품 대비 AP에서 상대적으로 높은 수준이다. 이에 따라 Exynos 채택 확대가 동사 Test Socket 매출 증가에 미치는 영향도 상대적으로 크다. 상반기 Galaxy S26 시리즈에 이어 하반기 Galaxy Z Flip8까지 Exynos 2600 적용 모델이 확대되면서 관련 Test Socket 수요가 하반기에도 이어질 것으로 예상되며, 2026년 Test Socket 매출은 전년 대비 33.1% 증가할 것으로 전망한다.

Interface Board & Test Socket 수출 비중 추이



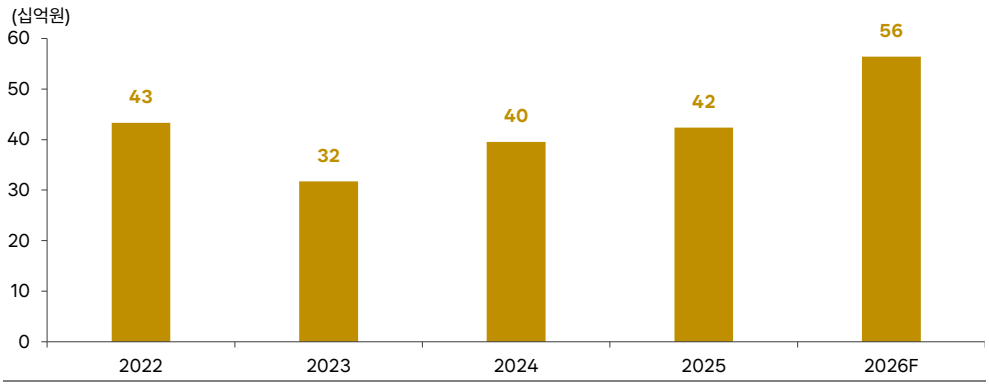
자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 Interface Board 매출액 추이 및 전망



자료: 티에스이, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 Test Socket 매출액 추이 및 전망



자료: 티에스이, 한국IR협의회 기업리서치센터

실적 추이 및 전망

1 Probe Card 성장, 자회사 실적은 엇갈린 2025년

2025년 연결 매출액 4,289억원(+23.2% YoY), 별도 매출액은 3,112억원(+40.8% YoY) 기록

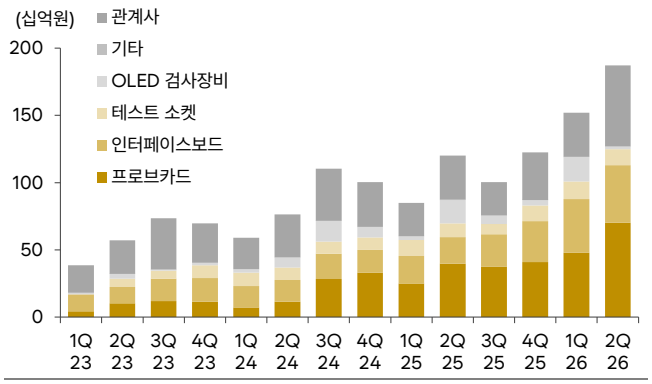
2025년 동사의 연결 매출액은 4,289억원(+23.2% YoY)을 기록하였다. 별도 매출액은 3,112억원(+40.8% YoY)으로 Probe Card와 Interface Board가 성장을 견인하였다. Probe Card 매출은 1,434억원(+78.7% YoY)으로 가장 높은 성장률을 기록하였다. 2024년부터 공급을 시작한 중국 DRAM 고객향 DRAM Probe Card 매출이 본격적으로 증가한 가운데 기존 NAND향 수요도 회복되었다. 중국 DRAM 고객향 매출 증가로 인해 Probe Card 내 DRAM 비중도 약 30%까지 상승하였다. Interface Board 매출은 946억원(+39.9% YoY)으로 메모리 투자 회복과 해외 비메모리 고객사향 공급 증가가 반영되었다. Test Socket 매출은 424억원(+7.2% YoY)으로 증가한 반면 OLED 검사장비 매출은 304억원(-8.7% YoY)으로 감소하였다.

자회사에서는 타이거일렉의 실적이 개선되었다. 타이거일렉 매출액은 807억원(+30.5% YoY), 영업이익은 72억원으로 전년 19억원 영업손실에서 흑자전환하였다. 반도체 업황 회복과 함께 Probe Card용 PCB 매출이 407억원(+41.9% YoY), Load Board용 PCB가 214억원(+35.4% YoY)으로 증가하며 실적 개선을 견인하였다. 반면 메가터치는 매출액 432억원(-18.4% YoY), 영업손실 42억원을 기록하며 전년 40억원 영업이익에서 적자전환하였다. Semiconductor 매출은 177억원(-8.9% YoY), Battery Pin 매출은 60억원(-62.7% YoY)으로 감소하였다. 지엠테스트 매출은 169억원(+5.5% YoY)으로 전년과 유사한 수준을 기록하였다.

2025년 연결 영업이익 492억원(+23.2% YoY, OPM 11.5%), 별도 영업이익 495억원(+29.3% YoY, OPM 15.9%) 기록

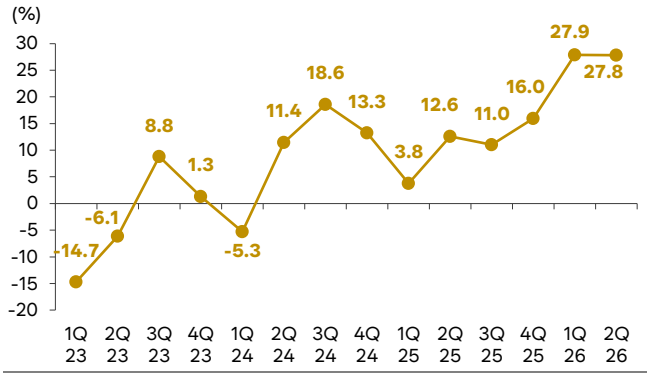
수익성 측면에서는 연결 영업이익 492억원(+23.2% YoY, OPM 11.5%), 별도 영업이익 495억원(+29.3% YoY, OPM 15.9%)을 기록하였다. 연결 영업이익률은 전년과 동일했으며 별도 영업이익률은 전년 대비 1.4%p 하락하였다. Probe Card와 Interface Board의 높은 매출 성장에도 신규 DRAM, HBM 제품 개발과 고객 대응을 위한 인력 및 개발 관련 비용 증가, 대손 관련 비용 등이 반영되면서 매출 증가에 따른 영업레버리지가 제한적이었다. 또한 메가터치의 적자가 타이거일렉의 실적 개선을 일부 상쇄하면서 연결 영업이익은 별도 영업이익과 유사한 수준에 그쳤다.

티에스이 부문별 매출액 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 분기별 영업이익률 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 사상 최대 실적 기대되는 2026년

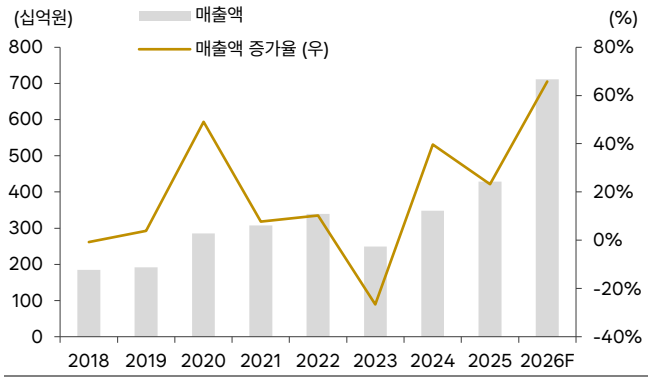
2026F 매출액 7,113억원 (+65.8% YoY), 영업이익 1,900억원 (+286.3% YoY) 전망

2026F 동사의 연결 매출액 7,113억원(+65.8% YoY), 영업이익 1,900억원(+286.3% YoY)을 전망한다. 1H26 연결 매출액은 3,394억원(+69.2% YoY), 영업이익은 945억원(+427.3% YoY)을 기록하였다. 별도 매출액은 2,466억원(+72.5% YoY), 영업이익 737억원(+268.1% YoY)을 기록하였다. Probe Card의 DRAM 및 HBM 매출 확대와 Interface Board의 해외 고객사향 공급 증가가 본사 성장을 견인했으며, 타이거일렉과 메가터치 등 자회사 매출액도 +61.1% YoY 증가하였다. 자회사 영업이익 기여도가 전년 상반기 적자에서 흑자전환하였다.

하반기에도 Probe Card와 Interface Board를 중심으로 성장세가 이어질 전망이다. 2026년 Probe Card 매출은 2,619억원(+82.6% YoY)을 전망한다. 중국 DRAM 고객향 DRAM 매출 증가가 지속되는 가운데 북미 고객사향 DDR5 및 HBM4, 국내 S사향 HBM4 공급도 확대되며 DRAM과 HBM 비중이 확대될 전망이다. Interface Board 매출은 1,676억원(+77.2% YoY)으로 메모리 투자 확대와 해외 비메모리 고객사향 공급 증가가 성장을 견인할 것으로 예상한다. Test Socket 매출은 564억원(+33.1% YoY)으로 Exynos 2600 적용 모델 확대에 따른 AP향 수요 증가가 반영될 전망이다. 관계사 매출도 타이거일렉의 Probe Card 및 Load Board용 PCB 수요 증가와 메가터치의 반도체 부문 회복에 힘입어 1,902억원으로 +61.5% YoY 증가할 것으로 예상한다.

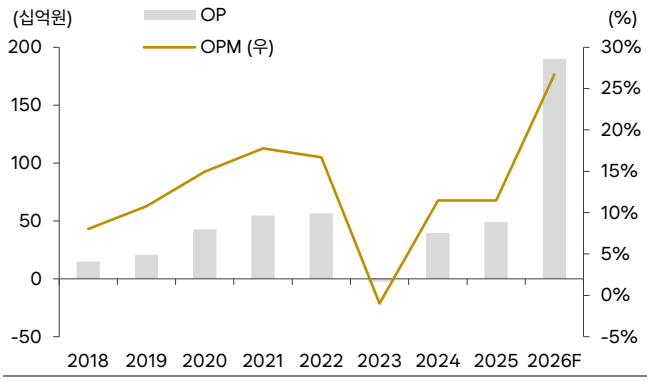
수익성 측면에서는 연결 OPM 26.7%(+15.2%p YoY)를 전망한다. Probe Card와 Interface Board의 매출 증가에 따른 가동률 상승으로 영업레버리지가 확대되는 가운데, 타이거일렉과 메가터치의 실적 개선도 연결 수익성 개선에 기여할 전망이다. 1H26 OPM은 27.8%를 기록했으며, 하반기에도 Probe Card와 Interface Board의 높은 매출 수준이 유지되면서 20% 중후반의 영업이익률이 이어질 것으로 전망한다.

티에스이 매출액 및 매출액 증가율 추이



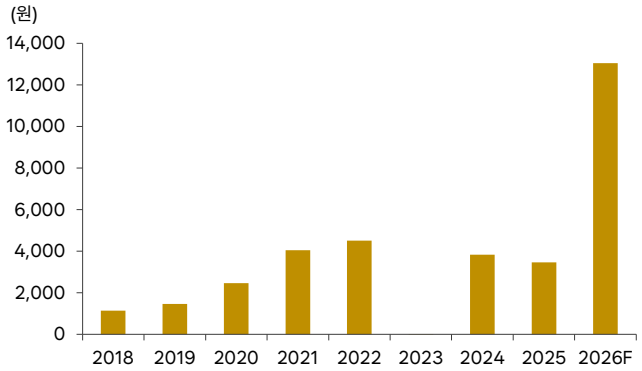
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 영업이익 및 영업이익률 추이



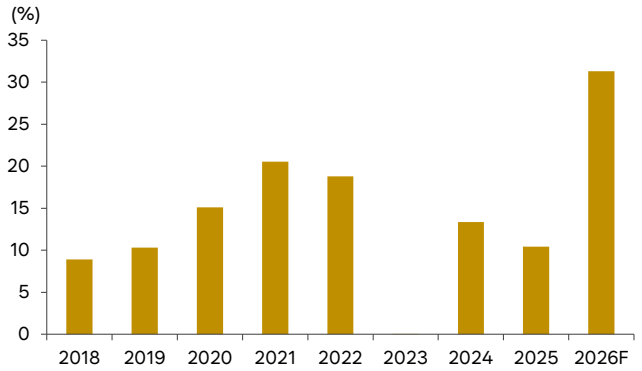
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 EPS 추이



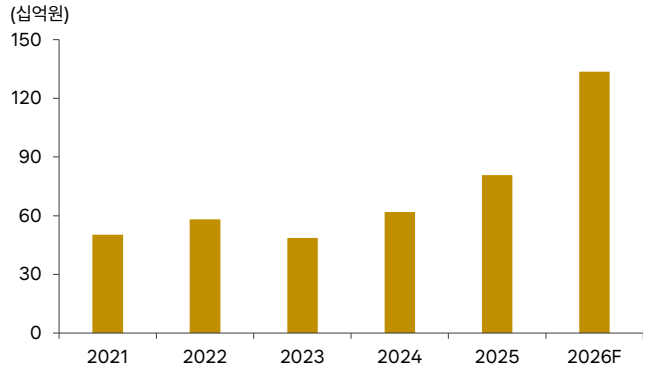
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 ROE 추이



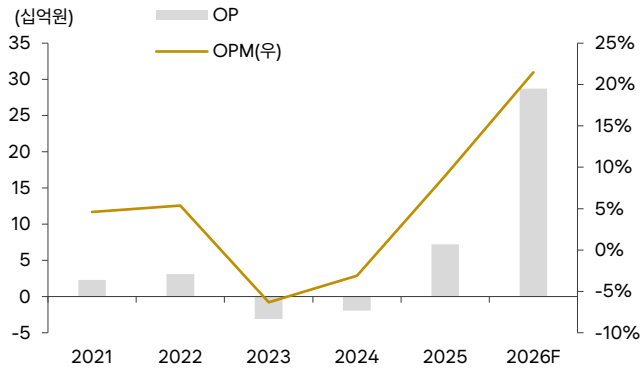
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

타이거일렉 매출액 추이



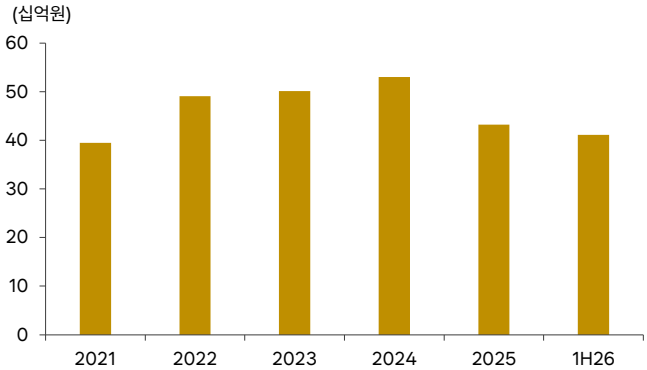
주: 26F는 시장 컨센서스 사용, 자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

타이거일렉 영업이익 및 영업이익률 추이



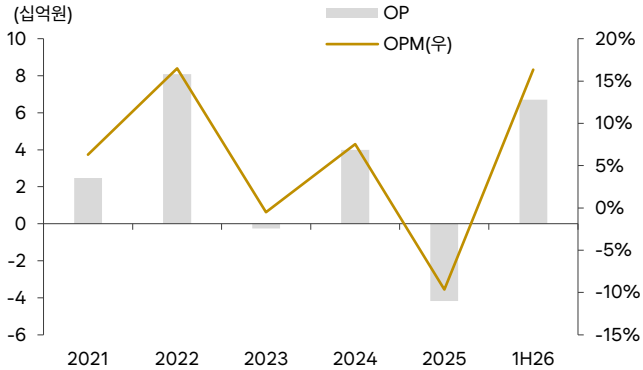
주: 26F는 시장 컨센서스 사용, 자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

메가터치 매출액 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

메가터치 영업이익 및 영업이익률 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 부문별 실적

(단위: 십억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2023	2024	2025	2026F
매출액	44.6	57.3	76.9	70.3	58.2	76.0	110.7	103.1	83.0	117.6	104.4	123.9	150.7	188.8	249.1	348.1	428.9	711.3
프로브카드	4.5	10.3	12.1	11.5	7.3	11.5	28.4	33.0	24.9	39.8	37.7	41.0	47.9	70.3	38.3	80.3	143.4	261.9
인터페이스보드	12.5	12.3	16.5	17.5	15.7	16.1	18.9	17.0	20.5	19.8	23.9	30.4	40.0	42.7	58.8	67.6	94.6	167.6
테스트 소켓	6.1	6.1	9.5	10.0	9.2	8.9	9.3	12.0	10.1	7.6	11.7	13.0	11.8	13.5	31.7	39.6	42.4	56.4
OLED 검사장비	1.1	3.5	0.8	2.0	2.5	7.7	15.5	7.6	2.7	17.4	6.5	3.9	18.1	2.1	7.4	33.3	30.4	34.8
기타	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
관계사	20.5	25.1	38.0	29.2	23.3	31.7	38.6	33.4	24.7	33.0	24.6	35.5	32.8	60.1	112.7	127.0	117.7	190.2
영업이익	-6.6	-3.5	6.8	0.9	-3.1	8.7	20.6	13.7	3.1	14.8	11.5	19.8	42.0	52.5	-2.4	39.9	49.2	190.0
지배주주순이익	-3.5	-3.3	6.2	0.8	-0.5	8.0	12.9	22.1	3.1	4.2	11.4	19.5	36.9	36.9	0.1	42.5	38.2	144.3
Margin(%)																		
영업이익률	-14.7	-6.1	8.8	1.3	-5.3	11.4	18.6	13.3	3.8	12.6	11.0	16.0	27.9	27.8	-1.0	11.5	11.5	26.7
지배주주순이익률	-7.9	-5.8	8.1	1.1	-0.8	10.5	11.6	21.5	3.7	3.6	10.9	15.7	24.5	19.5	0.0	12.2	8.9	20.3
YoYGrowth(%)																		
매출액	-44.9	-34.4	-13.9	-13.9	30.5	32.7	43.8	46.7	42.6	54.7	-5.7	20.1	81.5	60.5	-26.6	39.7	23.2	65.8
프로브카드	-74.3	-61.8	-51.9	-37.6	63.8	12.6	135.0	186.1	240.2	245.0	32.8	24.2	92.0	76.6	-56.4	109.4	78.7	82.6
인터페이스보드	-42.4	-38.8	-14.7	10.5	25.8	30.7	14.6	-3.2	30.3	23.2	26.9	79.2	95.3	115.6	-23.6	15.0	39.9	77.2
테스트 소켓	-53.2	-36.8	21.8	-22.2	52.7	45.4	-1.8	20.0	9.6	-15.4	25.1	8.1	16.3	79.1	-26.8	24.6	7.2	33.1
OLED 검사장비	-25.6	57.6	-85.2	-70.1	139.1	122.5	1,741.8	281.4	4.8	124.8	-58.1	-48.5	580.1	-87.7	-53.9	352.6	-8.7	14.3
기타	-	-	-	-42.0	-62.7	26.0	74.5	200.0	357.9	38.1	-1.1	-	-1.1	-9.2	-10.4	42.5	35.3	13.0
관계사	-25.3	-11.5	20.8	5.6	14.1	26.2	1.6	14.4	5.8	4.1	-36.3	6.3	33.0	82.1	-1.8	12.7	-7.3	61.5
영업이익	적전	적전	-22.6	-70.8	적지	흑전	204.4	1,389.2	흑전	70.0	-44.2	44.6	1,247	254.7	적전	흑전	23.2	286.3
지배주주순이익	적전	적전	-52.9	흑전	적지	흑전	107.5	2,832.8	흑전	-46.8	-11.3	-12.0	1,089.9	767.4	-99.8	35,031	-10.0	277.4
QoQGrowth(%)																		
매출액	-45.3	28.5	34.2	-8.7	-17.2	30.6	45.5	-6.8	-19.5	41.6	-11.2	18.6	21.7	25.3				
프로브카드	-75.8	129.2	17.7	-4.3	-36.5	57.5	145.8	16.5	-24.5	59.7	-5.4	8.9	16.7	46.9				
인터페이스보드	-21.2	-1.6	33.8	6.5	-10.2	2.3	17.3	-10.1	20.8	-3.3	20.7	27.0	31.7	6.7				
테스트 소켓	-53.0	1.4	55.0	5.4	-7.8	-3.4	4.7	28.8	-15.8	-25.5	54.8	11.2	-9.4	14.8				
OLED 검사장비	-84.0	226.7	-75.8	136.8	27.7	204.1	100.4	-51.0	-64.9	552.0	-62.7	-39.6	363.0	-88.2				
기타	2.0	-2.0	2.0	-43.1	-34.5	231.6	41.3	-2.2	-	-	1.1	-1.1	-1.1	-8.1				
관계사	-26.0	22.6	51.3	-23.1	-20.0	35.7	21.8	-13.4	-26.1	33.5	-25.5	44.5	-7.5	82.8				
영업이익	적전	적지	흑전	-86.4	적전	흑전	136.5	-33.6	-77.2	374.8	-22.4	72.2	112.4	25.0				
지배주주순이익	적지	적지	흑전	-87.8	적전	흑전	61.1	72.0	-86.0	36.9	168.4	70.7	89.6	-0.2				

자료: FnGuide QuantiWise, 한국IR협의회 기업리서치센터

Valuation

1 2026F PER 22.8x

현주가는 2026F PER 22.8x, PBR 6.2x로 Historical PER Band 중단 수준

동사의 현주가는 2026F PER 22.8x, PBR 6.2x로 Historical PER Band(10.0x~35.0x) 중단, PBR Band(1.0x~6.7x) 중상단에 위치해있다. 동사의 Peer 업체로는 국내외 Probe Card 및 Interface Board를 선정하였다. Technoprobe는 글로벌 Probe Card 및 Interface Board 선두 업체로 동사와 두 사업에서 경쟁하며, FormFactor와 Micronics Japan은 DRAM 및 HBM Probe Card의 주요 경쟁사이다. CHPT는 Load Board와 DUT Board 등 Test Interface 제품을 공급하고 있어 동사의 Interface Board 사업과 비교 가능하다. 피엠티는 국내 메모리 Probe Card 업체로 동사의 Probe Card 사업과 직접 비교 가능한 국내 Peer이다. Technoprobe, FormFactor, Micronics Japan, CHPT, 피엠티의 2026F PER은 각각 58.6x, 58.0x, 23.0x, 49.4x, 59.0x로 평균 49.6x 수준이다. 피엠티의 높은 PER은 2025년 적자 이후 이익 정상화 초기 단계로 2026년 이익 규모가 아직 낮고 2027년 수익성 회복 기대가 선반영된 영향이다. 국내 Probe Card 업체인 마이크로투나노도 사업적으로는 직접적인 Peer이나 비교 가능한 컨센서스가 없어 평균 산정에서는 제외하였다.

동사의 2026F PER은 Peer 평균 대비 약 54% 할인되어 거래되고 있다. FormFactor와 Micronics Japan 등 글로벌 메모리 Probe Card 업체들은 DRAM 및 HBM Probe Card에서 이미 다수의 양산 레퍼런스와 고객 기반을 확보하고 있는 반면, 동사는 2024년 중국 DRAM 고객향 DRAM 공급을 시작으로 2026년 북미 고객사향 DDR5 및 HBM4, 국내 S사향 HBM4 공급이 본격화되는 단계이다. 또한 타이거일렉과 메가터치 등 자회사 실적의 변동 폭이 크다는 점도 글로벌 Peer 대비 할인 요인이다.

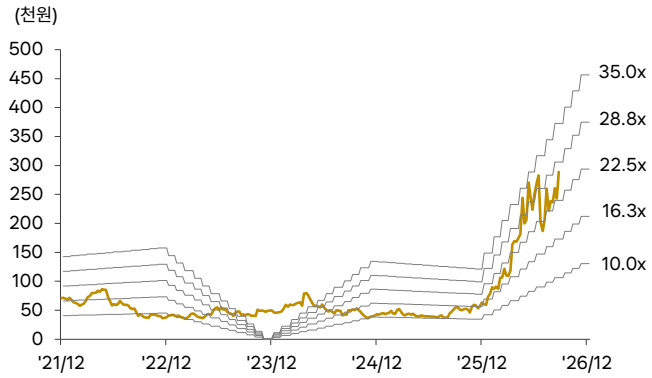
다만 할인 요인은 점차 완화될 것으로 전망한다. Probe Card는 중국 DRAM 고객향 DRAM 매출 증가에 더해 국내 S사와 북미 고객사향 HBM 공급이 확대되고 있으며, H사향도 HBM3E 승인 이후 차세대 제품으로 개발 범위를 확대하고 있다. Interface Board도 해외 비메모리 고객사향 공급 증가가 이어지고 있으며, 타이거일렉과 메가터치의 실적 개선으로 자회사 이익 기여도도 확대되고 있다. 향후 DRAM 및 HBM 양산 물량 확대와 Interface Board의 해외 고객사향 매출 증가가 지속될 경우 Peer 대비 PER 할인 폭도 축소될 것으로 전망한다.

동종 업종 밸류에이션

기업명	종가 (원, 달러)	시가총액 (십억원,백만달러)	매출액(십억원,백만달러)			PER(배)			PBR(배)		
			2024	2025	2026F	2024	2025	2026F	2024	2025	2026F
코스피	6,871	5,481,219	3,713,280	3,919,857	4,110,067	11.3	15.5	6.6	0.8	1.3	1.7
코스닥	850	478,093	332,962	361,554	135,682	210.6	112.9	24.8	1.5	2.1	3.0
티에스이	297,000	3,285	348	429	711	10.7	16.7	22.8	1.3	1.6	6.2
Technoprobe(이탈리아)	37	23,989	587	719	1,266	56.8	80.6	58.6	3.0	6.3	12.9
FormFactor(미국)	136	10,644	764	785	1,033	51.7	83.6	58.0	3.7	4.4	-
Micronics Japan(일본)	88	3,512	365	460	668	16.5	22.6	23.0	2.9	4.1	6.3
CHPT(대만)	99	3,245	110	153	227	56.9	75.3	49.4	3.6	8.5	8.2
피엠티	4,040	81	24	25	63	N/A	N/A	59.0	1.0	3.4	-
마이크로투나노	9,120	54	10	22	-	N/A	N/A	-	1.2	1.9	-
동종업종 평균						**45.5**	**65.5**	**49.6**	**2.6**	**4.8**	**9.2**

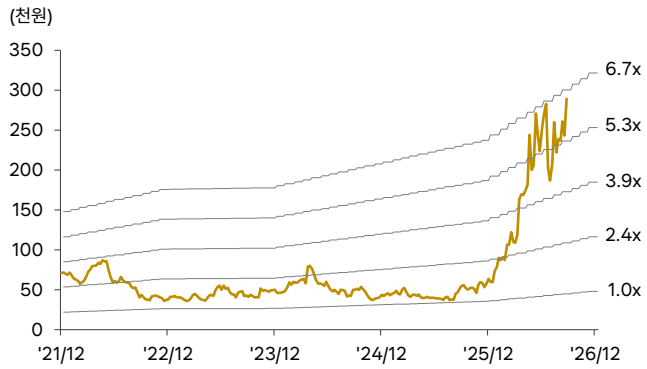
주: 1) 2026년 09월 29일 종가 기준. 동종그룹 26F는 시장 컨센서스 사용, 2) 마이크로투나노는 26F 컨센서스 부재, 자료: FnGuide QuantiWise, Refinitiv, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 PER Band



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

티에스이 PBR Band



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

리스크 요인

1 DRAM, HBM Probe Card 성장 지연과 자회사 실적 변동성

DRAM·HBM Probe Card 양산 확대 지연, 중국 메모리 투자 지연, 자회사 실적 변동성이 주요 리스크

DRAM, HBM Probe Card 양산 확대 지연

동사는 중국 DRAM 고객향 DRAM을 시작으로 북미 고객사와 국내 S사향 HBM까지 Probe Card 공급 범위를 확대하고 있다. 다만 고객사 인증 이후 실제 매출 규모는 양산 물량과 고객사 내 점유율 확대 속도에 따라 달라질 수 있다. 신규 제품의 양산 전환이 지연되거나 동사의 고객사 내 점유율 확대가 예상보다 늦어질 경우 DRAM 및 HBM Probe Card 매출 증가 폭이 낮아지면서 영업이익 추정치의 하향 요인으로 작용할 수 있다.

중국 DRAM 고객 및 중국 메모리 투자 지연

중국 DRAM 고객향 DRAM Probe Card는 동사의 DRAM 시장 진입 이후 매출 성장을 견인하고 있다. 2026년에도 중국 DRAM 고객의 CAPA 확대에 따라 관련 매출 증가를 예상하고 있어 신규 Fab 투자 및 가동 일정이 지연될 경우 Probe Card 매출 증가 폭도 낮아질 수 있다. 또한 대중국 반도체 규제 강화로 중국 DRAM 고객의 장비 조달이나 투자 일정에 차질이 발생할 경우 중장기 DRAM Probe Card 수요에도 영향을 미칠 수 있다.

자회사 실적 변동성

타이거일렉과 메가터치의 실적 변화는 동사의 연결 이익 변동성을 높이는 요인이다. 타이거일렉은 Probe Card 및 Load Board용 PCB 매출 비중이 높아 고객사의 테스트 투자와 Probe Card 수요 변화에 민감하며, 메가터치는 반도체 Test Pin과 Battery Pin 사업을 보유하고 있어 전방산업별 업황에 따라 실적 변동 폭이 크다. 실제로 2025년에는 Battery Pin 매출 감소로 메가터치가 적자전환한 반면, 타이거일렉은 Probe Card 및 Load Board용 PCB 매출 증가에 힘입어 흑자전환하였다. 2026년에는 두 자회사의 실적 개선이 연결 이익 증가에 기여하고 있으나, Probe Card 및 Load Board 수요 둔화나 메가터치의 반도체 부문 회복 지연이 발생할 경우 자회사 이익 기여도가 낮아지면서 연결 영업이익 추정치의 하향 요인으로 작용할 수 있다.

포괄손익계산서

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	3,393	2,491	3,481	4,289	7,113
증가율(%)	10.3	-26.6	39.7	23.2	65.8
매출원가	2,399	2,156	2,610	3,088	4,495
매출원가율(%)	70.7	86.6	75.0	72.0	63.2
매출총이익	994	336	870	1,201	2,617
매출이익률(%)	29.3	13.5	25.0	28.0	36.8
판매관리비	428	360	471	709	718
판관비율(%)	12.6	14.5	13.5	16.5	10.1
EBITDA	800	239	676	806	2,275
EBITDA 이익률(%)	23.6	9.6	19.4	18.8	32.0
증가율(%)	5.3	-70.1	182.4	19.3	182.3
영업이익	566	-24	399	492	1,900
영업이익률(%)	16.7	-1.0	11.5	11.5	26.7
증가율(%)	3.6	적전	흑전	23.2	286.3
영업외손익	82	-10	159	-19	57
금융수익	171	83	229	95	129
금융비용	93	95	75	128	75
기타영업외손익	5	3	5	15	4
종속/관계기업관련손익	6	-0	-3	4	4
세전계속사업이익	654	-34	555	477	1,960
증가율(%)	2.0	적전	흑전	-14.1	311.3
법인세비용	120	-13	104	76	392
계속사업이익	534	-21	450	400	1,568
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	534	-21	450	400	1,568
당기순이익률(%)	15.7	-0.8	12.9	9.3	22.0
증가율(%)	23.4	적전	흑전	-11.1	291.6
지배주주지분 순이익	498	1	425	382	1,443

재무상태표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
유동자산	2,282	2,073	2,689	3,106	4,797
현금성자산	524	386	450	758	1,435
단기투자자산	554	383	377	185	306
매출채권	676	666	1,074	1,077	1,581
재고자산	431	516	624	912	1,185
기타유동자산	98	122	164	175	290
비유동자산	2,076	2,358	2,505	2,974	3,280
유형자산	1,586	1,812	1,835	2,103	2,342
무형자산	151	160	175	186	172
투자자산	199	231	271	303	385
기타비유동자산	140	155	224	382	381
자산총계	4,358	4,431	5,194	6,080	8,077
유동부채	716	653	948	1,123	1,551
단기차입금	229	252	250	290	240
매입채무	110	99	162	198	299
기타유동부채	377	302	536	635	1,012
비유동부채	335	300	250	312	362
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	117	94	6	48	28
기타비유동부채	218	206	244	264	334
부채총계	1,051	953	1,197	1,435	1,913
지배주주지분	2,899	2,933	3,428	3,913	5,306
자본금	55	55	55	55	55
자본잉여금	312	405	428	472	472
자본조정 등	-57	-95	-70	-2	-2
기타포괄이익누계액	67	103	51	82	82
이익잉여금	2,522	2,465	2,963	3,305	4,699
자본총계	3,308	3,478	3,997	4,646	6,164

현금흐름표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
영업활동으로인한현금흐름	548	26	297	486	1,368
당기순이익	534	-21	450	400	1,568
유형자산 상각비	213	241	254	292	362
무형자산 상각비	21	22	23	22	14
외환손익	43	17	12	15	0
운전자본의감소(증가)	-207	-146	-517	-323	-570
기타	-56	-87	75	80	-6
투자활동으로인한현금흐름	-541	-337	-316	-346	-801
투자자산의 감소(증가)	7	-2	51	-3	-78
유형자산의 감소	5	2	5	5	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-496	-488	-270	-471	-600
기타	-57	151	-102	123	-123
재무활동으로인한현금흐름	214	154	59	143	99
차입금의 증가(감소)	-23	20	13	55	59
사채의증가(감소)	0	0	0	0	90
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	-53	-54	0	-43	-50
기타	290	188	46	131	0
기타현금흐름	7	19	24	25	11
현금의증가(감소)	229	-138	64	308	677
기초현금	295	524	386	450	758
기말현금	524	386	450	758	1,435

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025	2026F
P/E(배)	8.2	4,523.9	10.7	16.7	22.8
P/B(배)	1.4	1.9	1.3	1.6	6.2
P/S(배)	1.2	2.2	1.3	1.5	4.6
EV/EBITDA(배)	4.9	24.2	7.2	8.5	14.4
배당수익률(%)	1.4	0.0	1.0	0.8	0.2
EPS(원)	4,504	11	3,840	3,456	13,043
BPS(원)	26,205	26,517	30,988	35,375	47,969
SPS(원)	30,671	22,524	31,465	38,774	64,302
DPS(원)	500	0	400	450	450
수익성(%)					
ROE	18.8	0.0	13.4	10.4	31.3
ROA	13.2	-0.5	9.4	7.1	22.2
ROIC	18.4	-1.3	9.4	10.3	35.9
안정성(%)					
유동비율	318.9	317.4	283.8	276.7	309.3
부채비율	31.8	27.4	29.9	30.9	31.0
순차입금비율	-17.5	-6.4	-5.8	-6.3	-15.3
이자보상배율	42.0	-1.2	19.1	20.0	66.2
활동성(%)					
총자산회전율	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0
매출채권회전율	5.3	3.7	4.0	4.0	5.4
재고자산회전율	8.5	5.3	6.1	5.6	6.8

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
티에스이	O	O	X

2026년 09월 10일, 2026년 09월 29일 기준 투자경고 지정예고 및 해제에 따른 투자주의, 2026년 09월 11일 주가급등에 따른 투자경고 종목으로 지정된 바 있음. 2026년 09월 30일 현재 해제.

발간 History

발간일	제목
2026.10.01	티에스이-DRAM과 HBM으로 넓어지는 Probe Card
2023.02.22	티에스이-NAND 넘어 DRAM으로

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/kirsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.